

# 목 차

분기 보고서 .....	1
【대표이사 등의 확인】 .....	2
I. 회사의 개요 .....	3
1. 회사의 개요 .....	3
2. 회사의 연혁 .....	4
3. 자본금 변동사항 .....	10
4. 주식의 총수 등 .....	10
5. 정관에 관한 사항 .....	12
II. 사업의 내용 .....	14
1. 사업의 개요 .....	14
2. 주요 제품 및 서비스 .....	14
3. 원재료 및 생산설비 .....	15
4. 매출 및 수주상황 .....	18
5. 위험관리 및 파생거래 .....	20
6. 주요계약 및 연구개발활동 .....	21
7. 기타 참고사항 .....	23
III. 재무에 관한 사항 .....	36
1. 요약재무정보 .....	36
2. 연결재무제표 .....	39
2-1. 연결재무상태표 .....	39
2-2. 연결 포괄손익계산서 .....	40
2-3. 연결 자본변동표 .....	41
2-4. 연결 현금흐름표 .....	42
3. 연결재무제표 주식 .....	43
4. 재무제표 .....	82
4-1. 재무상태표 .....	82
4-2. 포괄손익계산서 .....	83
4-3. 자본변동표 .....	84
4-4. 현금흐름표 .....	85
5. 재무제표 주식 .....	86
6. 배당에 관한 사항 .....	119
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 .....	121
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 .....	121
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 .....	123
8. 기타 재무에 관한 사항 .....	123
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 .....	130
V. 회계감사인의 감사의견 등 .....	131
1. 외부감사에 관한 사항 .....	131
2. 내부통제에 관한 사항 .....	132
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .....	133
1. 이사회에 관한 사항 .....	133
2. 감사제도에 관한 사항 .....	134
3. 주주총회 등에 관한 사항 .....	136
VII. 주주에 관한 사항 .....	139
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .....	141

1. 임원 및 직원 등의 현황.....	141
2. 임원의 보수 등 .....	143
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	147
X. 대주주 등과의 거래내용.....	149
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항.....	150
1. 공시내용 진행 및 변경사항 .....	150
2. 우발부채 등에 관한 사항 .....	150
3. 제재 등과 관련된 사항.....	150
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 .....	151
XII. 상세표.....	152
1. 연결대상 종속회사 현황(상세).....	152
2. 계열회사 현황(상세).....	152
3. 타법인출자 현황(상세).....	153
【 전문가의 확인 】 .....	153
1. 전문가의 확인.....	153
2. 전문가와의 이해관계 .....	153

# 분기보고서

(제 18기 3분기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터  
2023년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

어보브반도체(주)

대 표 이 사 :

최 원

본 점 소 재 지 :

충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

(전 화) 02-2193-2200

(홈페이지) <https://www.abov.co.kr>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영본부 본부장 (성 명) 이 수 민

(전 화) 02-2193-2200

# 【 대표이사 등의 확인 】

20231113091820 - 경영지원팀 이덕현

## 대표이사 등의 확인·서명

### 확 인 서


우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 8 조의 규정에 따라 내부 회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2023년 11월 14일

어보브반도체 주식회사

대 표 이 사 최 원 (서명) 

신고업무담당임원 이 수 민 (서명) 

0288231113091820 - 1

# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

### 가. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	1	-	-	1	1
비상장	2	-	-	2	-
합계	3	-	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구분	자회사	사유
신규 연결	-	-
연결 제외	-	-

### 나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 어보브반도체 주식회사로 표기합니다. 또한 영문으로는 ABOV Semiconductor Co., Ltd. 라 표기합니다.

### 다. 설립일자 및 존속기간

당사는 비메모리반도체(MCU)를 개발하여 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 2006년 1월 11일 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2009년 06월 05일에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

### 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

전화번호 : 02-2193-2200

홈페이지 : <https://www.abov.co.kr>

### 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당
벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	해당

**바. 주요 사업의 내용**

당사는 비메모리 반도체 중 두뇌역할을 하는 반도체 칩인 Micro Controller Unit(MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 회사입니다. 팹리스의 특성상 제조는 파운드리 및 후공정 회사에 외주를 주고, 당사는 핵심 설계 및 외주관리를 통해 제품을 제조하고 있으며, 매출비중이 높은 기능별 제품은 Home Appliance이며 삼성전자 등 국내외 우수한 업체에 제품을 공급하고 있고, Motor, Power제어 및 BLE SoC 제품까지 사업 영역을 확대하고 있고 있습니다. 또한 당사가 21년~22년에 걸쳐 지분을 취득하여 당사의 주요종속회사로 편입된 (주)윈팩을 통하여 반도체 후공정 패키징&테스트 외주사업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

**사. 신용평가에 관한 사항**

(1) 최근 3년간의 신용평가 내역

평가일	신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	결산기준일	비고
2023.05.02	A-	(주)이크레더블 (AAA~D)	2022.12.31	정기평가
2022.04.22	A-	(주)이크레더블 (AAA~D)	2021.12.31	정기평가
2021.04.26	A-	(주)이크레더블 (AAA~D)	2020.12.31	정기평가

(2) 신용평가회사의 신용등급정의

신용등급	신용등급의 정의
AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임
AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음
BB	채무이행 능력에 문제가 없으나 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임
CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음
NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소, 정지, 변경

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함

**아. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항**

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
코스닥 상장	2009년 06월 05일	-	-

## 2. 회사의 연혁

### 가. 회사의 연혁

일시		내용
2023년	08월	글로벌 스타팍리스 집중육성 사업자 선정
	07월	한국거래소 2023년 코스닥라이징스타 선정
2022년	10월	(주)원팩 연결중속회사로 편입(지배력 획득)
	08월	한국거래소 2022년 코스닥라이징스타 선정
	01월	베트남 법인 설립
2021년	11월	(주)원팩 지분 취득
	05월	ISO 9001 / 14001 인증획득 (재인증)
	04월	중견기업 전환
2020년	12월	제 57회 무역의날 칠천만불 수출의 탑 수상
	12월	여성가족부 가족친화기업 인증
	01월	청년친화 우수강소기업 선정
2019년	12월	대한민국 기술대상 선정(한국산업기술평가관리원)
		Intelligent SAR sensor MCU 기술 확보
		산업통상자원부 장관상 수상
		한국수출입은행 히든챔피언 선정
2018년	05월	ISO 9001 / 14001 인증획득 (재인증)
	03월	연구개발기업 벤처기업 인증
2017년	12월	청년친화 우수강소기업 선정
	04월	기술혁신형 중소기업 inno-biz 인증취득
2016년	12월	매출액1,000억 돌파
	05월	청년친화 우수강소기업 선정
	01월	공장설비 증설
2015년	12월	제 52회 무역의날 오천만불 수출의 탑 수상
2014년	07월	본점 이전 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93)
	06월	World Class 300 Company 선정
2013년	12월	제 50회 무역의날 삼천만불 수출의 탑 수상
	01월	이타칩스(주) 흡수합병
2012년	05월	ISO 9001 / 14001 인증획득 (재인증)
	01월	중소기업청 "글로벌 강소기업" 선정
2011년	06월	이타칩스(주) 자회사로 편입
	05월	거래소 "코스닥형 프리히든 챔피언" 선정
	04월	이노비즈 인증획득(AA)
	01월	Midea(CN)주관 우수 공급업체 상 수상
2010년	10월	수출입은행 '히든챔피언' 선정

	09월	월매출 50억 최초 돌파
	03월	벤처기업 인증 (기술보증기금)
	03월	납세자의 날 기획재정부 장관상 수상
	01월	P검 장비 가동율 100% 달성
2009년	12월	ERP시스템 구축
	10월	광역경제권 R&D선도산업 선정(지식경제부)
	10월	저전력, 고효율 LED 제어용 MCU와 Driver IC 개발
	10월	벤처기업대상 수상(지식경제부장관상)
	09월	Voice IC 개발 및 양산
	09월	화인칩스(주) 지분투자 및 전략적 업무 제휴
	06월	코스닥 상장
	06월	12bit ADC(Analog Digital Converter) MCU 개발 및 양산
	03월	중국 상해사무소 개설
2008년	12월	지역산업 기술개발사업 선정 (지식경제부)
	10월	VFD(Vacuum Fluorescent Display) Driver IC 개발 및 양산
	10월	부품소재 기술개발사업 선정 (지식경제부)
		u-Healthcare MCU 개발
03월	연구개발기업 벤처기업 지정(기술보증기금)	
2007년	12월	신인사시스템 구축
	12월	사업화연계 기술개발사업 선정(지식경제부)
		고성능 8bit MCU 개발
	11월	Segment LED Driver IC 개발 및 양산
	05월	중소기업기술 혁신개발사업 선정(중소기업청)
		저전력 SOC 설계 Platform 개발
	05월	수출유망기업선정 (수출입은행)
	05월	Flash LCD MCU 개발 및 양산
	03월	본점 이전 (충북 청주시 흥덕구---> 충북 청원군 오창읍)
01월	국제표준규격(ISO) 환경방침 인증	
2006년	12월	지점 설치(충북 청원군 오창읍)
	10월	In line P-검 생산 체계 구축
	06월	국제표준규격(ISO) 품질방침 인증
	04월	Flash MCU 개발 및 양산
	03월	중국 심천사무소 개설
	03월	신기술기업 벤처기업 지정 (중소기업청)
	03월	우량기술기업 인증 (기술신용보증기금)
	03월	기업부설연구소 인증 (서울/청주 연구소 등록)
	01월	지점 설치 (서울 강남구 대치동)
	01월	"어보브반도체" 법인(충북 청주시 흥덕구) 및 홍콩법인 설립



나. 종속회사의 연혁  
 [(주)원택]

일 시		내 용
2022년	10 월	유상증자(제3자배정, 증자후 자본금 297.92억원)
2021년	12 월	최대주주 변경((주)티엘아이 -> 어보브반도체(주))
	11 월	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(어보브반도체 주식회사)
	11 월	유상증자(제3자배정, 증자후 자본금 248.34억원)
2019년	12 월	일자리창출 대통령 표창
	3 월	SK하이닉스 Flip Chip 양산 개시
	2 월	2018년 용인시 성실납세자 선정
2018년	12 월	2018년 경기도 일자리 우수기업 인증서 수상
	11 월	PKG 신공장 증축
2017년	12 월	유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모, 증자후 자본금 170.46억원)
2016년	4 월	TSG 당뇨인슐린 패치 지분 취득
	3 월	티엘아이 eMMC Turnkey(PKG+TEST) 양산 개시
	3 월	대표이사 변경(이한규 -> 이한규, 이민석 (각자 대표))
	2 월	대표이사 변경(김달수 대표 -> 이한규 대표)
	1 월	센소니아 근조도센서 양산 개시
2015년	5 월	티엘아이 T-CON 양산 개시
	4 월	POP제품 Infra 확보
	3 월	습도센서 양산 개시
2014년	9 월	응용복합제품 양산 개시(CI-MCP, E-NAND)
	4 월	대표이사 변경(유상태 임기 만료 퇴임 -> 김달수 단독 대표)
2013년	7 월	SOC(비메모리) 공장 증축
	3 월	코스닥시장 상장(자본금 71억)
	3 월	대표이사 변경(유상태 -> 유상태, 김달수(각자 대표))
	2 월	PKG 1,000일, TEST 2,000일 품질무사고 달성(SK하이닉스)
2012년	12 월	5천만불 수출의 탑 수상
	12 월	코스닥시장 상장예비심사 승인
	5 월	유상증자(제3자배정, 증자후 자본금 58.36억원)
	3 월	2012년 경기도 성실납세자 선정
	3 월	전환상환우선주 보통주 전환(전환가격 1,747원/주, 2,290,040주)
2011년	9 월	TEST 사업부 품질무사고 1,500일 달성 기념패 수상 (SK하이닉스)
	4 월	최대주주 변경 (한성엘컴텍 → 티엘아이)
	1 월	유상증자(제3자배정, 증자후 자본금 43.58억원)
2010년	5 월	TEST 사업부 품질무사고 1,000일 달성 기념패 수상 (SK하이닉스)
	2 월	사무동 및 TEST동 건축 준공
2009년	10 월	TEST 사업부 품질무사고 800일 달성 (SK하이닉스)

	9 월	PKG 사업부 품질무사고 500일 달성 기념패 수상 (SK하이닉스)
	9 월	경기도 유망중소기업 선정
2008년	12 월	TEST 사업부 품질무사고 500일 달성 기념패 수상 (SK하이닉스)
	9 월	대표이사 변경 (김준오, 유삼태 (각자대표) → 유삼태)
	6 월	SK하이닉스 MCP 외주 전문업체 선정
	5 월	대표이사 변경 (김준오 → 김준오, 유삼태(각자대표))
2007년	6 월	DRAM (DDR3) 제품 임가공 계약 체결 (SK하이닉스)
	6 월	TS16949 인증 취득 (TEST 사업부)
	2 월	TEST 사업부 신설
2006년	12 월	INNO-BIZ 기업 인증 (A등급, 중소기업청)
	11 월	TS16949 인증취득 (PKG 사업부)
	9 월	경영혁신형 중소기업 확인서 취득 (경기지방중소기업청)
	3 월	ISO 14001 인증 취득
2005년	5 월	부속 연구소 설립 (한국 산업기술 진흥협회)
	5 월	벤처기업 인증 (경기 지방 중소기업청)
	3 월	경기도 용인 사옥 신축 및 본사 이전
2004년	12 월	유상증자 (제3자배정, 증자후 자본금 31.5억원)
	12 월	DDR2 BoC 제품 임가공 계약 체결 (SK하이닉스)
	6 월	ISO 9001 인증 취득
	6 월	Assy 임가공 계약 체결 (144Ball_SK하이닉스)
	2 월	회사 상호 및 주소지 변경 (아이팩/이천 → 윈팩/평택)
	2 월	최대주주 변경 (아이랩 → 한성엘컴텍)
2003년	8 월	유상증자 (주주배정, 증자후 자본금 24억원)
	8 월	대표이사 변경 (서성원 → 김준오)
	5 월	유상증자 (주주배정, 증자후 자본금 5억)
	4 월	주식회사 아이팩 설립(설립자본금 1억) 대표이사 서성원

#### [ABOV Semiconductor (HK) Co Limited]

일시		내용
2013년	03월	순덕사무소 개설
2009년	03월	상해사무소 개설
2006년	01월	법인설립, 심천사무소 개설

#### [ABOV Semiconductor VINA Co., Ltd]

일시		내용
2022년	01월	법인설립

**다. 회사의 본점 소재지 및 변동**

- 해당사항 없음.

**라. 경영진의 중요한 변동**

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2018년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 최원	-
2019년 03월 21일	정기주총	사내이사 한대근 사외이사 김경호	사내이사 김영진	사내이사 채재호(임기만료)
2021년 03월 25일	정기주총	감사 채재호	대표이사 최원	-
2022년 01월 03일	-	-	-	사외이사 김경호(사임)
2022년 03월 24일	정기주총	사외이사 박성우	사내이사 김영진 사내이사 한대근	-
2023년 03월 28일	정기주총	사내이사 김경호	-	사내이사 김영진(사임)
2023년 06월 23일	-	대표이사 김경호	-	-

주1) 2023년 06월 23일 이사회결의를 통하여 김경호 사내이사가 대표이사로 신규 선임 됨 으로서, 최원 대표이사의 단독 대표이사 체제에서 각자 대표이사 체제로 변경 되었습니다.

**마. 최대주주의 변동**

- 해당사항 없음

**바. 상호의 변경**

- 해당사항 없음

**사. 종속회사의 상호의 변경**

**[(주)윈팩]**

변경일자	2004.02.10 (임시주주총회 상호 변경 결의)
상 호	주식회사 아이팩 → 주식회사 윈팩(WINPAC INC.)

**[ABOV Semiconductor (HK) Co Limited]**

- 해당사항 없음

**[ABOV Semiconductor VINA Co., Ltd]**

- 해당사항 없음

**아. 화의, 회사정리절차 등**

- 해당사항 없음

**자. 합병 등에 관한 사항**

- 2013.01.01 이타칩스(주)(소멸회사)를 흡수합병함

### 차. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음

## 3. 자본금 변동사항

### 가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	18기 3분기 (2023년 09월말)	17기 (2022년말)	16기 (2021년말)	15기 (2020년말)	14기 (2019년말)
보통주	발행주식총수	17,780,753	17,780,753	17,459,653	17,459,653	17,459,653
	액면금액	500	500	500	500	500
	자본금	8,890,376,500	8,890,376,500	8,729,826,500	8,729,826,500	8,729,826,500
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	8,890,376,500	8,890,376,500	8,729,826,500	8,729,826,500	8,729,826,500

## 4. 주식의 총수 등

### 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,780,753	-	17,780,753	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-
1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-
	4. 기타	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	17,780,753	-	17,780,753	-
V. 자기주식수	1,281,999	-	1,281,999	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	16,498,754	-	16,498,754	-

## 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
	소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	-	
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유수량	보통주	1,281,997	-	-	-	1,281,997	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	1,281,997	-	-	-	1,281,997	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	2	-	-	-	2	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	1,281,999	-	-	-	1,281,999	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

## 다. 자기주식 직접 취득·처분 이행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간		예정수량 (A)	이행수량 (B)	이행률 (B/A)	결과 보고일
	시작일	종료일				
직접 처분	2019년 12월 19일	2019년 12월 26일	50,000	50,000	100	-
직접 처분	2020년 03월 02일	2020년 03월 02일	100,000	100,000	100	-
직접 처분	2020년 10월 15일	2020년 10월 15일	70,000	50,000	71	-

※ 상기 자기주식처분 결정은 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식을 교부한 경우로 '증권의 발행 및 공시 규정' 제5-9조 4항에 의거하여 처분결과보고서 제출은 생략하였습니다.

## 라. 자기주식 신탁계약 체결·해지 이행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간		계약금액 (A)	취득금액 (B)	이행률 (B/A)	매매방향 변경		결과 보고일
	시작일	종료일				횟수	일자	
신탁 해지	2018년 07월 09일	2019년 01월 08일	1,800,000,000	1,633,235,600	91	-	-	2019년 01월 08일
신탁 해지	2020년 03월 20일	2020년 09월 21일	3,500,000,000	172,740,000	5	-	-	2020년 09월 25일
신탁 해지	2022년 04월 15일	2022년 10월 17일	5,000,000,000	4,993,987,200	99	-	-	2022년 10월 17일

주1) 상기 2020년 03월 20일부터 2020년 09월 21일에 체결한 신탁계약의 취득금액 및 이행률의 50% 미만 사유는 다음과 같습니다.

- 2020년 3월 주가가 저점에 접어들어 당사는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위하여 신탁계약을 체결 하였으며, 계약금액의 일부를 취득하였습니다. 이후 지속적으로 주가를 관찰 하였으나, 주가 상승 및 안정세를 보여 신탁계약을 만기 해지 하였습니다.

**다. 종류주식(명칭) 발행현황**

- 해당사항 없음

## 5. 정관에 관한 사항

**가. 정관의 최근개정일 등**

- 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 28일 입니다.

**나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부**

- 해당사항 없음

**다. 정관 변경 이력**

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2023년 03월 28일	제17기 정기주주총회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제12조의2(주주명부의 작성 비치)</li> <li>- 제13조(기준일)</li> <li>- 제14조(전환사채의 발행)</li> <li>- 제15조(신주인수권부사채의 발행)</li> <li>- 제27조의2(서면에 의한 의결권의 행사)</li> <li>- 제33조 (대표이사 등의 선임)</li> <li>- 제44조 (이익배당)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자증권법 개정 반영</li> <li>- 주주명부폐쇄일 변경</li> <li>- 전환사채 발행한도 증액</li> <li>- 신주인수권부사채 발행한도 증액</li> <li>- 서면결의 제도 삭제</li> <li>- 수인의 대표선임 근거 마련</li> <li>- 배당기준일 정비</li> </ul>
2021년 03월 25일	제15기 정기주주총회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제9조 (주식등의 전자등록)</li> <li>- 제10조의2(주식매수선택권)</li> <li>- 제10조의3(신주의 동등배당)</li> <li>- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</li> <li>- 제14조(전환사채의 발행)</li> <li>- 제17조(소집시기)</li> <li>- 제40조(감사의 수와 선임)</li> <li>- 제42조(재무제표 등의 작성 등)</li> <li>- 제44조(이익배당)</li> <li>- 제44조의2(분기배당)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자등록 의무화에 따른 정관규정 변경</li> <li>- 신주의 동등배당 및 배당기준일 원칙 명시</li> <li>- 주총개최시기 유연성 확보 위해 조문정비</li> <li>- 감사선임 관련 조문정비</li> </ul>
2019년 03월 21일	제13기 정기주주총회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제9조(주식 및 신주인수권증서의 전자등록)</li> <li>- 제10조(신주인수권)</li> <li>- 제10조2(주식매수선택권)</li> <li>- 제11조(명의개서대리인)</li> <li>- 제15조의3(사채 및 신주인수권증권의 전자등록)</li> <li>- 제16조(사채발행에 관한 준용규정)</li> <li>- 제33조(대표이사 등의 선임)</li> <li>- 제34조(이사의직무)</li> <li>- 제42조2(외부감사인의 선임)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주식 및 신주인수권 증서의 전자등록 근거조항 신설</li> <li>- 외부감사법 개정에 따른 외부감사인 선정권한 변경내용 반영</li> </ul>

라. 사업목적현황

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	반도체의 운영, 도안, 제조 및 판매	영위
2	반도체 제조 서비스의 제공	영위
3	전자부품 및 전자기기 판매 및 서비스업	영위
4	컴퓨터, 통신장비 제조판매 및 서비스업	영위
5	소프트웨어 개발 판매 및 서비스업	영위
6	제조장비 판매 및 서비스업	미영위
7	인터넷 통신판매 및 서비스업	미영위

## II. 사업의 내용

### 1. 사업의 개요

당사는 1,000여가지 이상의 다양한 가전용 전자기기 및 산업용 전자기기 등에 적용되는 MCU 제품을 공급하고 있으며, MCU 이외에도 Touch Sensor, Ambient Light Sensor 등의 각종 Sensor 제품 및 High Voltage 소자가 적용되는 Power 반도체 제품을 공급하고 있습니다.

당사의 주력 사업은 가전용 전자기기에 사용되는 8-bit, 32-bit MCU이며 신성장 동력으로 Motor, Power 제어 및 BLE SoC 제품까지 MCU 기술을 활용한 사업 영역을 확대하여 국내 및 중국 시장, 그리고 최근 몇 년간은 유럽, 인도 및 터키 시장을 개척하고 있습니다. MCU 기술의 핵심 중에 하나인 각종 아날로그IP에 대해서는 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 자체 개발만으로는 Time-to-Market 달성이 어려운 최신 고성능 아날로그 또는 디지털IP 기술을 개발하는 유망한 스타트업 업체들에 초기 투자를 진행하며 국내 팹리스계 ABOV Alliance를 구성하여 전략적으로 기술 저변을 확대하고 있습니다.

당사는 국내 MCU No.1 Provider로서 지속적인 기술투자 및 연구개발로 고객의 니즈에 최적화된 제품을 개발합니다. MCU 제품은 S/W와 결합하는 제품으로 반도체 칩만을 제공해서는 판매가 가능한 시장이 아니며 고객이 어보브반도체의 제품으로 고객의 제품을 개발하기 위해서는 고객의 H/W, S/W 개발 환경을 다양한 형태로 함께 제공되어야 합니다. 고객의 제품 개발 전 과정에 대한 Ecosystem을 이해하며 고객의 가치 사슬 전방위에서 편의성과 가치를 제공하기 위한 고객 감동에 최선을 다하고 있습니다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

당사는 삼성전자, LG전자, 위니아, 위닉스 등 국내 가전사들을 비롯하여 중국의 Midea, XIAOMI, Lenovo 및 일본, 유럽, 미국의 우수한 업체에 제품을 공급하며, 당사의 주요 종속회사인 (주)원팩을 통하여 반도체 공정의 주요한 세부공정 중 패키징(PKG)과 테스트(TEST)를 포함하는 반도체 후공정 외주사업을 영위하고 있습니다.

공시대상기간의 각 제품 기능별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	제18기 3분기		제17기		제16기	
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
Home Appliance	56,678	33%	120,528	50%	90,444	54%
Mobile Solution	10,058	6%	15,971	7%	29,939	18%
Remote Controller	7,943	5%	19,028	8%	17,010	10%
Power Solution	7,333	4%	14,768	6%	13,647	8%



Smart Consumer	14,786	9%	14,011	6%	8,644	5%
Fire & Safety System	7,358	4%	7,482	3%	1,727	1%
BLE & Connectivity	326	0%	400	0%	572	0%
패키징(PKG)	54,296	32%	39,831	16%	-	-
테스트(TEST)	9,002	5%	4,655	2%	-	-
others	4,533	2%	5,903	2%	5,516	3%
총합계	172,313	100%	242,577	100%	167,499	100%

※ 상기 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.

### 3. 원재료 및 생산설비

#### [MCU 사업부문 (어보브반도체(주))]

##### 가. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 주요 원재료는 1차 가공 처리된 Wafer로 키파운드리(前 매그나칩 반도체)에서 분사 형태로 출법한 당사의 특성상 키파운드리(前 매그나칩 반도체)의 의존도가 높으나 국내외 파운드리와 신규 공정 개발 중이며, 점차 다변화 시켜 생산하려고 하고 있습니다.

각 제품 기능별 매입액 및 총 매입액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부 문	품 목	구체적용도	제18기 3분기		제17기		제16기	
			매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율
MCU	AS MCU (전용 제품)	ECO(친환경)	2,574	12%	5,493	9%	3,823	8%
		MIMO(센서)	4,292	20%	6,176	10%	9,979	20%
		REMO(리모콘)	1,063	5%	1,722	3%	1,660	3%
		VISO(3D,VOICE IC)	73	1%	173	0%	239	1%
	GP MCU (범용 제품)	Flash	539	2%	936	2%	660	1%
		Full Flash	13,048	60%	45,195	74%	31,719	64%
		OTP	0	0%	13	0%	164	1%
	Peripheral IC	Logic	43	0%	419	1%	183	0%
	Other	Other	36	0%	602	1%	1,055	2%
	합계			21,668	100%	60,729	100%	49,482

※ 상기 원재료 매입액은 별도 재무제표 기준입니다.

##### 나. 생산 및 설비에 관한 사항

당사는 MCU를 전문으로 설계, 생산하는 팹리스 업체로, 파이널 테스트를 제외한 전체 제품을 외주업체에 위탁하고 있습니다. 2015년 1분기 부터 구축한 파이널 테스트라인을 통하여 개발활용 및 자체 생산능력을 확보하여 운영중에 있습니다.

##### 다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(단위 : 초, 개수, 천원)

주요공정	구분	제18기3분기	제17기	제16기
파이널테스트	시간(초)	136,080,000	181,440,000	181,440,000
	PCS(개수)	90,720,000	120,960,000	120,960,000
	금액(천원)	1,156,680	1,542,240	1,542,240

주1) 시간(초) : 근무일수(연 300일) \* 24시간(1,440분) \* 60초 \* 보유장비(Final Test 7대)

주2) PCS(개수) : 생산능력(초) / 개당 표준 테스트 시간(1.5초)

주3) 금액(천원) : 초당 단가 8.5원 적용 (생산운영비 / 생산실적(초))

주4) 상기 생산능력은 별도 재무제표 기준입니다.

## 라. 생산실적 및 가동률

### (1) 파이널테스트 생산실적 및 가동률

(단위 : 초, 개수, 천원)

주요공정	구분		제18기3분기	제17기	제16기
파이널테스트	생산능력	시간(초)	136,080,000	181,440,000	181,440,000
		PCS(개수)	90,720,000	120,960,000	120,960,000
		금액(천원)	1,156,680	1,542,240	1,542,240
	생산실적	시간(초)	24,857,854	95,422,372	92,819,302
		PCS(개수)	16,571,903	63,614,915	61,879,535
		금액(천원)	211,292	811,090	788,964
	가동률		18.27%	52.59%	51.16%

※ 상기 생산실적은 별도 재무제표 기준입니다.

### (2) 파이널테스트 상세 생산실적

(단위 : 개수)

장비명	대수	1일 생산실적(개수)			연간 평균가동 일수	누계 생산실적(개수)			비고
		제18기3분기	제17기	제16기		제18기3분기	제17기	제16기	
		연평균	연평균	연평균		누계	누계	누계	
T3347A	7	73,653	212,050	206,265	300일	16,571,903	63,614,915	61,879,535	-
계	7	73,653	212,050	206,265	300일	16,571,903	63,614,915	61,879,535	-

※ 상기 생산실적은 별도 재무제표 기준입니다.

## 마. 생산설비 현황 등

(단위 : 천원)

사업소	소유 형태	구분	소재지	기초장부 가액	당기		당기 상각	기말장부 가액
					증가	감소		
본사	자가	건물	오창	870,048	-	-	(58,433)	811,615

본사 및 지점	자가	기계장치	오창	1,357,804	1,711,520	-	(286,517)	2,782,807
	자가	사무비품	오창/서울	159,855	117,305	-	(84,016)	193,144
	자가	설비자산	오창/서울	274,529	29,290	-	(128,868)	174,951
	자가	차량운반구	오창/서울	47,654	-	(11,380)	(10,426)	25,848
	자가	건설중인유형자산	-	1,581,875	-	-	(1,581,875)	-
합 계				4,291,765	1,858,115	(11,380)	(2,150,135)	3,988,365

※ 상기 생산설비 현황은 별도 재무제표 기준입니다.

## [ PKG, TEST 사업 부문(주요종속회사인 (주)원팩) ]

### 가. 매입현황

(단위 : 천원)

매입 유형	품목	구분	2023년 3분기	2022년	2021년
원재료	Substrate	국내	17,243,923	49,987,941	25,883,330
		수입	2,317,044	5,738,489	3,662,073
		소계	19,560,967	55,726,430	29,545,403
	Gold Wire	국내	2,360,038	6,257,922	6,625,160
		소계	2,360,038	6,257,922	6,625,160
	Wbl Tape	국내	1,007,295	2,545,977	1,416,154
		소계	1,007,295	2,545,977	1,416,154
	기타	국내	5,881,601	16,205,939	9,466,628
		수입	1,495,560	1,658,762	4,461,971
		소계	7,377,161	17,864,701	13,928,599
	총합계	국내	26,492,857	74,997,779	43,391,272
		수입	3,812,604	7,397,251	8,124,044
		소계	30,305,461	82,395,030	51,515,316

(\*) 원재료 주요 품목의 상세 내역은 다음과 같습니다.

품목	내 용
Substrate	- 절연기판 표면에 도체 패턴을 형성할 수 있는 절연재료 - 표면에 구리로 배선이 되어 집적회로나 저항 등의 전기 부품을 장치해 사용하는 합성수지판
Gold wire	- substrate와 wafer die가 전기적으로 연결되도록 칩 연결에 쓰이는 wire - 시간이 지나도 재성능을 낼 수 있도록 전기적 연결이 좋아야 함 - Gold 재질이 전기적 연결성능이 좋으며, 가공성도 우수함
WBL Tape	- Wafer backside laminating의 약자로서 칩과 칩 사이를 연결하여 주는데 사용하는 TAPE - 칩의 적층시 사용하는 Tape

## 나. 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분		2023년 3분기	2022년	2021년
Substrate (ea)	국내	136.41	106.96	117.09
	수입	105.63	92.40	63.79
Gold wire (kft)	국내	112,276.82	107,672.44	96,887.40
	수입	-	-	-
WBL Tape (sheet)	국내	13,475.52	11,210.82	7,998.61
	수입	-	-	-

(\*) 상기 원재료 가격변동 추이는 각 품목별 총매입액을 매입수량으로 나누어 산출하였습니다.

## 다. 생산능력 및 생산실적

(단위 : KPCS)

제품명	구분	2023년 3분기	2022년	2021년
패키징 (*1)	생산능력	346,690	647,208	518,971
	생산실적	125,971	479,193	259,581
	가동률	36.3%	74.0%	50.0%
테스트 (*2)	생산능력	305,054	459,482	388,218
	생산실적	17.4%	126,277	102,774
	가동률	17.4%	27.5%	26.5%

(\*1) 패키징 생산능력 및 가동률

- 생산능력 = DA 장비수(누적평균) \* 표준제품 UPEH \* 22.5hr(조업시간)  
\* 30일(표준근무일수) \* 12M

- 가동률 = 생산실적(실생산수량) / 생산능력, 기준공정 Die Attach 기준

(\*2) 테스트 생산능력 및 가동률

- 생산능력 = (3600초[1시간]/(TESTTIME+ INDEX)) \* 가동률(70%) \* PARA  
\* 24시간 \* 30일 \* 장비댓수 \* 12M

- 가동률 = 각 제품별로 산출한 실 가동률

## 4. 매출 및 수주상황

### 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

구 분			2023년 3분기	2022년	2021년
MCU	제품	내수	71,264	135,534	99,402
		수출	35,057	60,469	67,865
		합계	106,321	196,003	167,267

	상품	내수	126	210	129
		수출	13	78	103
		합계	139	288	231
PKG	제품	내수	10,312	2,999	-
		수출	43,984	36,832	-
		합계	54,296	39,831	-
TEST	용역	내수	5,234	3,233	-
		수출	3,768	1,422	-
		합계	9,002	4,655	-
기타	상품	내수	2,491	250	-
		수출	64	1,549	-
		합계	2,555	1,799	-
합계		내수	89,427	142,226	99,531
		수출	82,886	100,350	67,968
		합계	172,313	242,576	167,499

※ 상기 매출실적은 연결 재무제표 기준입니다.

## 나. 판매방법 및 조건

### [MCU 사업부문 (어보브반도체(주))]

#### (1) 판매경로

당사의 판매경로는 직접판매와 대리점을 통한 간접판매의 두 가지 형태가 있습니다.

판매구분	주요 사항
직접판매	마이크로 컨트롤러라는 집적 반도체는 내재된 일반적인 기능 블록을 사용 할 수 있다는 점에서 범용 제품인 동시에 고객별로 필요한 응용목적에 따라 반도체에 내장된 특수 기능 블록을 사용 한다는 점에서 일종의 전용 제품이라고 할 수 있습니다. 따라서 개발단계부터 수요자인 전자업체와 제품의 사양 및 특성 등에 관한 지속적인 논의를 통하여 제품을 개발하고, 판매가 이루어집니다. 따라서 지속적으로 안정적인 수요가 확실하고 신제품 사양을 선도하는 규모가 큰 전자업체를 겨냥하여 신제품을 기획하고, 개발된 제품을 고객으로부터 평가받은 후 판매하며, 동 업체에서 검증된 제품을 일반 시장의 불특정 고객에게 판매하기 위한 목적으로 일정 규모의 기술력 및 생산 규모를 가진 전자 업체들을 분류하여 직접 판매를 하고 있으며, 이외에 매출 채권회수 등의 위험성이 적으면서 대량 생산 설비를 갖춘 고객들 또한 당사가 직접 판매를 시행하고 있습니다.
간접판매	당사가 생산 판매하는 마이크로 컨트롤러 및 드라이버 반도체는 칩셋 건조기 같은 소형 가전제품에서 전자레인지 등의 백색 가전 및 블루레이 디스크드라이버 같은 정보가전 제품까지의 모든 전자제품을 아우르는 영역에서 단순표시 기능에서부터 복잡한 시스템 제어 용도로 사용되고 있습니다. 따라서 그 수요처가 무궁무진하고, 업체별로 사용 수량도 천차만별입니다. 따라서 고객 대응에 대한 효율성 및 제품 판매 후의 고객지원 및 매출채권 회수의 편의성을 위하여 대리점, 디자인 하우스 및 리셀러를 통하여 판매하고 있습니다.

## (2) 판매방법 및 조건

### ① 판매 방법

고객사 주문을 받아 영업조직을 통해 End Customer에 직접 영업 및 대리점 판매

### ② 판매 조건

선수금, T/T 또는 익월 말 현금 조건 (담보 조건) Local L/C, 구매확인서

## [ PKG, TEST 사업 부문(주요종속회사인 (주)원팩) ]

### (1) 판매 경로

매출유형	품목	구분	판매경로
제품	PKG	내수	수주-주문-생산(패키징)-납품-입금
		수출	
용역	TEST	내수	수주-주문-입고-TEST-출하-입금
		수출	
상품	-	내수	수주-주문-출하-입금
		수출	

### (2) 판매 전략

종속회사의 제품은 주문생산제품으로 별도의 대리점이나 영업소를 두고 있지 않고 내부에서 자체적으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 종속회사는 고객별로 고객이 발주물량에 대하여 직접 조회 가능하도록 설계된 시스템을 통해 고객별 발주물량을 효율적으로 관리하여 적시에 제품을 생산함으로써, 고객의 생산량 변동에 최대한 빠르게 대응하고 있습니다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

### 가. 주요 시장 위험의 내용

당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 관리하고 있습니다. 특히 당사는 주요 제품의 해외수출로 인한 외화수금 시 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리 대상입니다.

연결실체는 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY입니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

### 나. 위험관리 방식

당사는 체계적이고 지속적인 환위험관리 업무를 경영지원부서에서 수행하고 있으며 별도의 환헤지 금융상품에 가입하고 있지는 않습니다. 주요 원자재인 Wafer 등이 USD 베이스로 계

약되어 있고 결제 시 결제일 기준 환율로 처리되고 있어 환차손의 발생가능성이 있으며 보유 의화를 적절히 환전하는 방법 등으로 환리스크를 최소화 하고있습니다.

※ 자세한 사항은 『Ⅲ. 재무에 관한 사항』 중 "연결재무제표 주석" 및 "재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

**다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황**

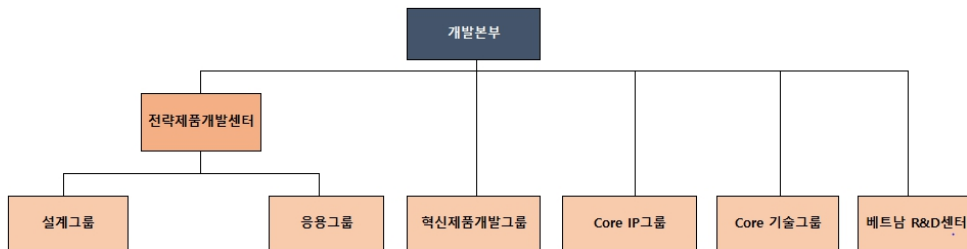
당사의 연결 중속회사의 전환사채와 관련하여 조기상환청구권의 공정가치를 파생상품 부채로 계상하고있습니다. 동 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항』 중 "연결재무제표 주석" 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

**6. 주요계약 및 연구개발활동**

**[MCU 사업부문 (어보브반도체(주))**

**가. 연구개발활동의 개요**

(1) 연구개발 담당조직



(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제18기 3분기	제17기	제16기
연구개발비용 계	18,453,916	24,274,901	20,917,127
연구개발비용 / 매출액 비율	17.93%	12.49%	13.09%

※ 상기 비율은 별도 매출액 대비 비율입니다.

**나. 연구개발 실적**

당사는 MCU 전문회사로서 각종 MCU 및 MCU 주변에 사용되는 Driver IC를 개발하고 있습니다. 당사의 최근 개발 완료된 제품 실적 개요는 아래와 같습니다.

연도	구분	개발실적	제품명	비고
2023	MCU	3종	A94P829	고속충전 MCU
			A31L214	32bit Ultra Low Power MCU
			A31L222	32bit Ultra Low Power MCU
2022	MCU	9종	AL8844	RGB sensor IC
			A94B517	무선충전 MCU
			MC96F7816S	LCD리모컨 MCU
			A94B910	스마트폰용 고속충전 MCU
			MC96F7864S	LCD리모컨 MCU
			MC97F2664AS	MWO,냉장고용 MCU
			A96G150	MWO용 MCU
			A96T3A6	7채널 SAR 센서 MCU
			A96L623	네트워크식 화재감지기 MCU
2021	MCU	4종	A94Q427	Car Charger
			A96L533	Smoke Detector
			A96T396	TWS용 SAR센서
			A31T216	Touch/LCD/LED용 MCU

다. 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없음

[ PKG, TEST 사업 부문(주요종속회사인 (주)원팩) ]

1. 연구개발 활동

가. 연구개발 담당조직





나. 연구개발 비용

(단위 : 천원)

구분		2023년 3분기	2022년	2021년
비용처리	판관비	430,503	540,054	436,094
연구개발비용 합계		430,503	540,054	436,094

다. 연구개발 실적

연도	개발실적	연구개발명
2023	2종	(Inline)RDL_WF + 150um GAL공법 적용한 F82 DDR5 플립칩 패키지 개발
		고용량 256GB(512GbX4) 임베디드 UFS_4.0 패키지 개발
2022	25종	RDL_WF + 125um SD공법 적용한 F82 DDR5 플립칩 패키지 개발
		4-Die Stack 32Gb(8Gb LPDDR5x4) Mobile용 315B 패키지 개발
		2-Die Stack 16Gb(8Gb LPDDR5x2) Mobile용 315B 패키지 개발
		4-Die Stack 32Gb(8Gb LPDDR5x4) Mobile용 200B 패키지 개발
		Dumped Die NAND를 이용한 153B eMMC_5.1 패키지 개발
		3-Die embedded Stack(64Gb+8Gb) Automotive통신모듈용 162B 패키지 개발
		팔라듐 코팅 구리(PdCu) 와이어를 적용한 16x16 120LQFP 패키지 개발
		메인스트림 스토리지 F132 패키지 개발 외 17
2021	19종	128GB ROM/6GB RAM(10nx세대) 10단 uMCP(UFS+LPDDR4X)패키지 개발
		128GB ROM/6GB RAM(10ny세대) 8단 uMCP(UFS+LPDDR4X)패키지 개발
		4-Die Stack 32Gb(8Gb LPDDR4x4) Mobile용 200B 패키지 개발
		보급형 149B(4Stack) eMCP 패키지 개발
		64GB ROM/6GB RAM(10ny세대) 7단 uMCP(UFS+LPDDR4)패키지 개발
		50um SDBG와 C-mold공정을 적용한 메인스트림 스토리지 F132 패키지 개발
		High Speed Switching SPDT를 적용한 3x3-13LGA 패키지 개발
		사무용 PC, 테블릿 PC용 10x10_144B 패키지 개발
		10yn 60um SDBG 공법 적용한 10x15-F200 패키지 개발
		2-Die Stack 16Gb(8Gb LPDDR4x2) 10x15_F200 패키지 개발
		기타 임베디드 UFS_4.0 패키지 개발 외 8종

## 7. 기타 참고사항

### [MCU 사업부문 (어보브반도체(주))]

#### 가. 지적재산권 현황

당사는 사업경쟁력 확보를 위하여 보고서 작성기준일 현재 지적재산권(특허권, 실용신안권, 상표권 등)을 아래와 같이 보유하고 있습니다.

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 건)

구분	국내	해외	계
특허	60	33	93
특허출원	23	22	45
실용신안출원	1	-	1
상표	2	-	2
계	86	55	141

#### 나. 환경 관련 규제 사항

당사는 국제규격의 환경경영시스템인증 ISO14001을 취득 및 운영하고 있습니다. 이를 바탕으로 법규준수와 더불어 환경오염물질 발생을 최소화하고 있습니다.

#### 다. 업계의 현황

당사는 MCU(Microcontroller Unit), System-on-Chip(SoC)와 같은 시스템반도체와 Driver IC, Sensor 외 다양한 Discrete 반도체까지 종합적으로 개발하는 회사입니다. 당사의 주력 제품인 MCU는 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 전자 부품으로 시장조사전문기관인 옴디아에 따르면 MCU 시장은 2021년 부터 2026년 까지 연평균 성장률 7.4%를 기록할 것이라 예상 하고 있습니다.

세계 MCU 시장은 크게 가전과 자동차, 산업용으로 구분되며, 당사의 사업은 가전 MCU를 주력으로 하면서 모바일, 산업용으로 까지 그 사업영역을 확대하고 있습니다.

'23년 04월 Gartner에 따르면 최근 세계 경제의 급속한 악화로 인한 소비자 수요의 감소로 2023년 전체 반도체 시장 예상 매출은 \$532B로 2022년 대비 약 11.2% 감소할 것으로 예상되지만 2023년 하반기 부터 시장 점차 회복이 되어 2024년도에 예상되는 매출규모는 \$630B로 다시 호황기에 접어 들 것으로 예상 됩니다.

**Table 1. Semiconductor Revenue Forecast, Worldwide, 2022-2024 (Billions of U.S. Dollars)**

	2022	2023	2024
Revenue	599.6	532.2	630.9
Growth (%)	0.2	-11.2	18.5

Source: Gartner (April 2023)

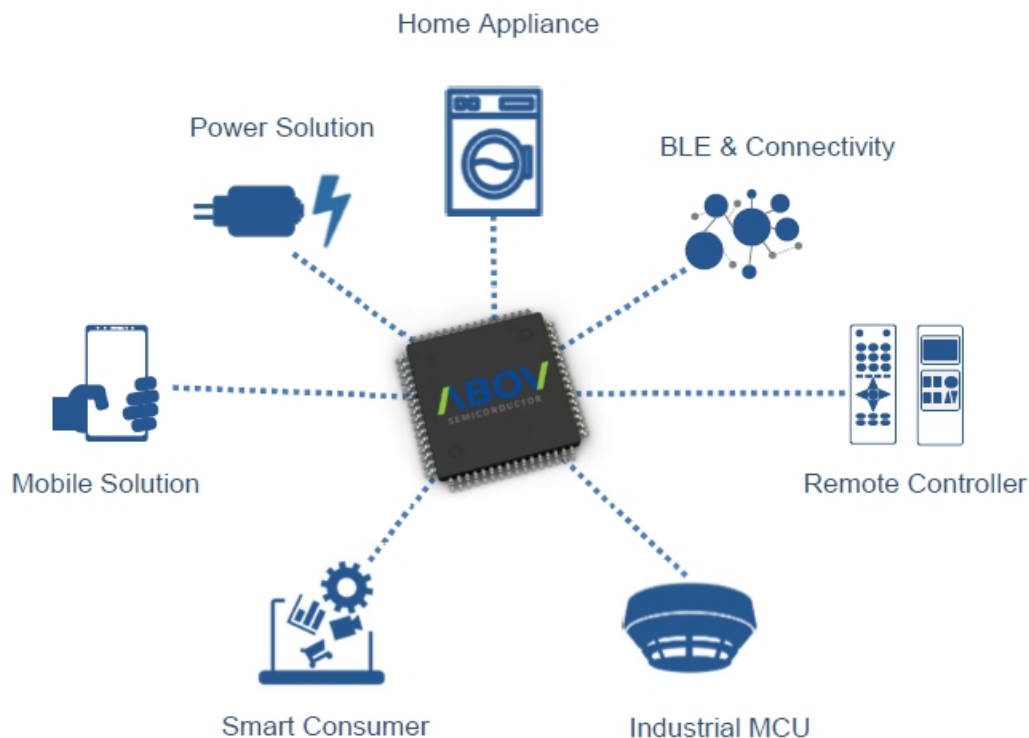
(출처: <Gartner Forecasts Worldwide Semiconductor Revenue Growth in 2023>)

## 라. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 백색가전, TV, 모바일 및 소형 가전 MCU 등 400여 가지의 다양한 전자제품에 MCU를 공급하고 있으며, Touch Sensor, Ambient Light Sensor 등의 Sensor 사업 및 각종 Driver IC를 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 8-bit, 32-bit MCU이며 신 성장 동력으로 Motor, Power 제어 및 BLE SoC 제품까지 MCU 기술을 활용한 사업 영역을 확대하여 국내 및 중국 시장, 그리고 최근 몇 년간은 유럽, 인도시장을 개척하고 있습니다.



당사는 다른 팹리스 기업에서 갖기 힘든 Final Test 자체 생산 라인을 오창 본사에 확보, 원가를 절감시키기 위해 노력하고 있으며, MCU 회사의 핵심인 각종 아날로그 IP의 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성 IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 자체 개발만으로는 Time-to-Market 달성이 어려운 최신 고성능 아날로그 또는 디지털 IP 기술을 개발하는 유망한 스타트업 업체들에 초기 투자를 진행하며 국내 팹리스계 ABOV Alliance를 구성하여 전략적으로 기술 저변을 확대하고 있습니다.

당사는 국내 MCU No.1 Provider로서 지속적인 기술투자 및 연구개발로 고객의 니즈에 최적화된 제품을 개발합니다. MCU 설계 기술 강화를 위한 스타트업 투자, 산학 협력, 국가 과제 수행 등 다양한 방법으로 역량을 강화하고 있습니다. 또한 MCU 시장이란 반도체 칩만으로 판매가 가능한 시장이 아니며 고객이 어보브반도체의 제품으로 고객의 제품을 개발하기 위해서는 다양한 기술 지원과 소프트웨어 역량, 각종도구들이 함께 제공되어야 합니다. 고객의 제품 개발 전 과정에 대한 Ecosystem을 이해하며 고객의 가치 사슬 전방위에서 편의성과 가치를 제공하기 위한 고객 감동에 최선을 다하고 있습니다.

당사의 주요 판매 거래처는 아래와 같습니다.

국내	해외
삼성전자 (KR)	Midea (CHN)
LG전자 (KR)	Universal Electronics Inc. (US)
위니아 (KR)	XIAOMI (CHN)
오성전자 (KR)	Lenovo (CHN)
쿠쿠전자 (KR)	유럽가전사 (EU)
위닉스 (KR)	Sharp (JPN)

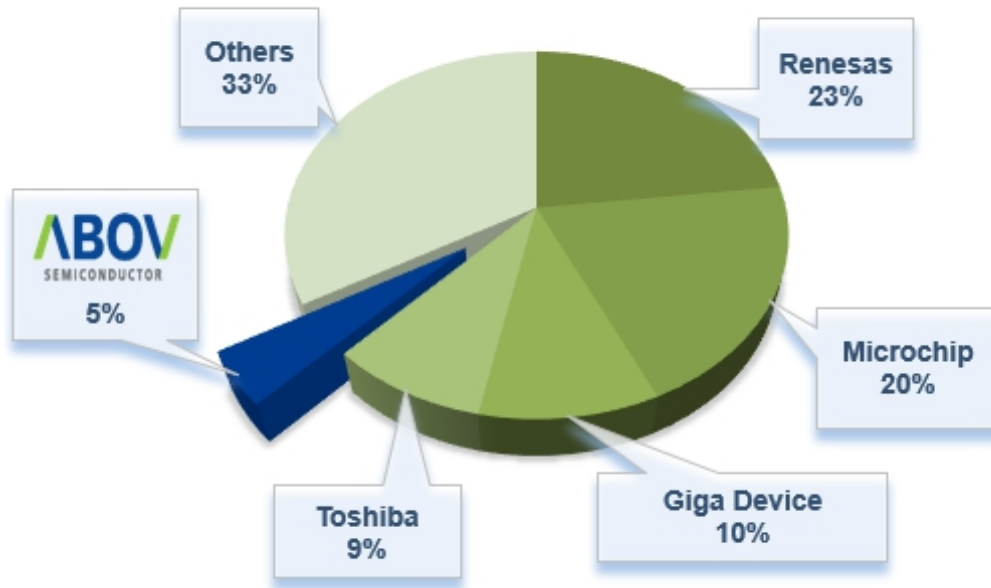
(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	사업내용	비고
다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체소자제조업	비메모리반도체 개발/제조	마이크로컨트롤러유닛(MCU)

(2) 시장점유율

소비자 가전용 MCU 시장의 경우 세계적인 시장 조사 기관인 IHS의 조사에 따르면 2022년 매출 기준 세계 5위의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. (출처: IHS MCU Market Tracker, 2022 시장 조사 자료)

2022 Consumer Electronics MCU Market Share



### (3) 주요 제품

#### ① 범용 MCU (General purpose MCU)

범용 MCU는 특정 고객 및 Application으로 기획하지 않고, 일반적으로 사용되는 MCU입니다. 다품종 소량생산이 특징이며, 주로 Line-up 전략에 의해 제품을 개발합니다. 제품 특성 및 가격이 중요한 제품으로 당사는 자체 확보하고 있는 NVM 설계 기술 및 아날로그 IP 설계 기술로 IC Size를 획기적으로 축소시킴으로써, 고객들에게 경쟁력 있는 단가를 제시합니다. 또한 고객의 요구 사항에 빠르게 대응하여, 주변 부품을 내장하여 고객의 비용을 절감하는 신규 제품을 창출하며, 고객의 부가가치 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 고객이 Set를 개발하기 위한 Tool 및 Software도 자체 개발 및 제공함으로써 고객에게 MCU의 Total Solution을 제공하고 있습니다.

최근 IoT의 시장의 성장과 더불어 Sensor와 함께 MCU에서도 Low Power의 특성이 특히 중요하게 요구되고 있습니다. 당사도 최근 급성장하는 사물인터넷 및 배터리 동작 응용 시장을 겨냥, 소모전류 성능을 크게 개선한 초저전력 제품군을 새롭게 출시하여 고객에게 더 다양한 옵션과 효율적인 솔루션을 제공함으로써 사물인터넷 및 센서 응용 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.

#### ② Touch MCU

정전 방식으로 터치 센서를 터치할 경우 정해진 동작을 하도록 제어하는 MCU로 터치키는 많은 전자제품에 사용되면서 기본으로 내장되고 있는 성능입니다. 당사의 Touch MCU는 세계 최고의 휴대폰 회사에 적용된 바 있으며, 터치 기능이 특히 중요한 가전에도 폭넓게 적용되는 등, 당사는 Touch MCU의 선발주자로서 그 위상을 확대하고 있습니다.

최근 몇 년 간 휴대폰에 필수화된 전자과흡수율 (Specific Absorption Rate: SAR) 관련 규제가 강화되며 어보브반도체의 SAR Sensor 제품이 국내와 중국의 선두 스마트폰 제품들에 적용되었습니다. SAR Sensor는 인체가 근접해 있는지를 감지하는 센서로, 전자 제품들의 인체 근접성을 계산하여 전자 제품이 무선 안테나 출력을 낮추게 해주는 역할을 합니다. SAR Sensor는 전자과흡수율 기준치를 충족하는 매우 까다로운 공인 인증이 필요한데, 어보

브반도체의 SAR Sensor는 까다로운 기준을 모두 통과하여 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 이러한 세계적인 기술력 보유의 성과로 2019년 12월, 2019 대한민국 산업기술 R&D 대전 기술대상에서 산업통상부 장관상을 수상하였습니다.

현재는 최신 트렌드에 맞게 True Wireless Stereo(TWS) 무선 이어폰의 착용 감지 및 터치 제어를 위한 Touch 센서, 단계별 터치 세기를 인식 가능한 Force Touch 센서 등을 개발하며 급변하는 고객의 요구사항을 선도적으로 대응함에 따라 Touch MCU 시장 부분에서 세계 최고 수준의 Market Leader로써 후발주자와의 격차를 벌이고 있습니다.

### ③ Power MCU

스마트폰 충전기 및 이동전원(또는 보조배터리, Power Bank로 칭함)용 MCU를 공급하고 있으며 최근 시장에 출시되고 있는 USB Type-C PD 3.0 등의 고속 충전 사양을 지원하는 MCU 제품을 출시하여 폭발적인 시장에 가장 먼저 대응하고 있습니다. 당사의 파워 솔루션은 UFC (Universal Fast Charging Interface) 솔루션으로 USB Type-C PD 3.0 표준, 기존 Battery Charger 1.2 등의 구형 표준과 단말기 업체별로 차별화된 전용 고속 충전 프로토콜까지 다양한 고속 충전 인터페이스를 MCU를 사용하여 Programmable하게 지원하는 Total Solution입니다.

USB Type-C기반의 충전기술이 소비자가전 및 자동차 등 다양한 응용에서 적용되고 있으며, 특히 동시에 여러가지 디바이스를 고속으로 충전할 수 있도록 Power Bank 및 Travel Adaptor에서 멀티 포트 적용이 확대되는 추세로 어보브반도체는 선도적으로 듀얼 포트 USB Type-C PD 제품을 출시하여 시장의 요구에 적극적으로 대응하며 해당 시장에 지속적으로 투자와 연구를 진행 중에 있습니다.

### ④ BLE SoC

당사는 블루투스 저전력 4.2 IP의 확보를 통해 2018년 말 aBLE 블루투스 저전력 4.2 SoC 제품을 출시하였습니다. BLE 4.2는 현재 다양한 무선충전 패드 등에 적용되고 있으며, 뿐만 아니라 개발 과정에서 함께 해 온 알파 고객들의 제품에 적용되어 현재 IoT 블랙박스, 스마트폰 액세서리, 웨어러블 기기 등 다양한 응용으로 개발 및 양산되고 있습니다. 향후 추가적으로 aBLE 4.2 제품을 사용한 콘서트 응원봉, 스마트 신발 깔창, 의류용 액세서리, 휴대용 의료기기 등의 다양한 고객들의 창의력이 반영된 제품들에 적용이 될 계획입니다.

또한 당사는 블루투스 저전력 5.0를 지원하는 IP관련 2019년 말 신기술 인증 획득하였고, 2020년 블루투스 저전력 5.2를 지원하는 프로토콜 스택에 대한 인증을 획득하였습니다. 소프트웨어 기반 블루투스 저전력 프로토콜과 각종 전용 무선 프로토콜을 설정하여 사용할 수 있는 기술을 확보하게 되면서 시장의 다양한 IoT Needs를 충족시킬 수 있을 것으로 보입니다. 기존 주력시장인 MCU 사업에서 센서 및 RF 솔루션으로 사업을 확장하여, IoT 시장에서 주도적으로 자리매김할 수 있도록 박차를 가할 예정입니다.

### ⑤ Industrial MCU

당사는 Fire & Safety (소방안전)용 제품 Lineup을 보유함으로써, 기존 주력 시장인 가전, 모바일에서 산업용으로 시장을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 주요제품으로는 네트워크형, 독립형 연기감지기 MCU (Smoke Detector MCU)등이 있으며, 당사는 전력통신 송수신 제품까지 출시 함으로써 명실 공히 소방 안전 관련 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

### ⑥ Motor용 MCU

현재 백색가전에는 Motor를 구동시키는 MCU가 1개 이상씩 들어가며 주로 32-bit 제품군으로 구성되어 있습니다. 당사는 백색 가전에 들어가는 Motor용 MCU 뿐만 아니라, 선풍기, 카메라 등의 소형 가전용 Motor MCU도 개발하고 있습니다. 전 세계 MCU의 시장의 30% 이

상이 Motor MCU인 광활한 사업 영역인 만큼 당사는 차세대 주력 Lineup으로 Motor용 MCU를 개발하고 있습니다. 사용자 환경에 따른 차별화된 알고리즘이 중요한 사업영역으로 고객에게 Total Solution을 제공하고 있습니다.

#### ⑦ 리모컨 MCU

리모콘은 주로 에어컨 리모컨에 사용되는 LCD 리모컨과 셋탑박스에 많이 사용되는 만능 리모컨 (Universal Remote Controller, UR) 두 종류가 있습니다. 주요 고객사는국내외 가전사 및 각종 셋탑박스 업체입니다. 당사는 세계 가전 MCU No.5이며, 리모컨 MCU에서는 세계 M/S. 1위를 점유하고 있습니다.

#### ⑧ 조도센서/칼라센서

어보브반도체는 높은 감도와 넓은 다이내믹 레인지를 지원하는 조도센서 및 컬러센서 제품군의 포트폴리오를 제공합니다. 디스플레이 밝기 제어 및 정확한 색상 측정 및 판별 기능을 구현함으로써 적용되는 어플리케이션의 전력 소비량을 줄이는데 도움을 줍니다. AL8844 제품은 정밀한 색상 측정 및 판별을 위한 기술이 적용되었습니다. 가시광선 영역에 IR 성분을 차단하는 필터를 적용하였으며, 자체 데이터 처리 알고리즘을 통해 매우 정확한 색상 측정이 가능합니다.

#### (4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 근 4-5년 간 사물인터넷(IoT)의 핵심은 MCU라는 것을 인지하고 현재의 MCU 기술을 확산되어 가는 IoT 동향에 발 맞추기 위한 핵심 기술 확보에 심혈을 기울이고 있습니다. 한 쪽에는 MCU가 IoT 제품들에 사용되기 위한 플랫폼 기술에 대한 연구를, 다른 한 쪽에는 각 가전 제품을 연결할 수 있도록 하는 무선 통신 기술에 대한 연구를 진행하여 왔습니다.

또한 당사는 저전력 기술 확보를 통한 초저전력 MCU 제품의 개발, 고성능 아날로그IP의 확보를 통한 소방, 방재 기기의 정밀 측정 MCU 제품 개발, 에너지 하베스터로 구동되는 반영구 초저전력 MCU까지 신제품 개발에 주력하고 있습니다. RF 커넥티비티, 역치전압에서 구동하는 초저전력 설계 기술, 고성능 아날로그 IP를 사용한 센싱 기술, 그리고 더욱 개선된 제품 성능과 안정성, 마지막으로 고객의 응용에 특화된 알고리즘을 직접 개발 또는 확보하여 모든 기술을 집약한 Smart MCU의 개발을 지향하고 있습니다.

또한 Low Power, High Frequency 시장의 트렌드에 맞는 MCU 제품의 출시 및 High Precision Sensor 관련 Analog Front End를 지속적으로 개발 확보함으로써, 제품의 Lineup을 다양하게 확대, 전개할 예정입니다.

최근 2-3년 급부상하고 있는 Artificial Intelligence 시장에 맞는 Smart MCU 관련해서도 중기 미래를 위한 성장동력을 준비함으로써, 차세대 기술을 위한 선도적인 기술 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 한편으로는 정부 과제를 통한 원천 기술 확보를 위해 산학협력을 추진하고 있으며, 현재 저사양 MCU를 사용한 기계 학습의 트렌드인 TinyML (Tiny Machine Learning) 시장 진출을 위해 경량화 인공지능 S/W 플랫폼을 확보하는 노력을 하고 있습니다

국내 시장의 규모만으로는 회사의 성장에 한계가 있어 당사는 근 몇 년새 국내에서 벗어나 중국의 소비자 가전 시장에서 시장 지배력을 확대하며 현재 세계 시장의 열 손가락 안에 드는 업체가 되었습니다. 세계적인 경쟁사들이 즐비한 미주, 유럽, 일본 등의 시장에서의 판매 확대를 위해 파트너사 확대 및 해외지사를 설립하고 있으며 동남아, 인도 등의 신흥 시장에

서도 판매 확대를 위해 심혈을 기울이고 있습니다.

어보브반도체가 지난 2006년 창사 이래 15년 간 가전 MCU 시장의 세계 5위라는 자리까지 올라오면서 가전 시장에 대해서는 확고한 장악력을 확보하였습니다. COVID-19로 인한 지각 변동은 시장 구조를 선두주자만이 살아남을 수 있는 환경으로 만들었으며 사회는 급격하게 변화하고 있습니다. 어보브반도체는 근 몇 년간 축적한 초저전력 MCU 플랫폼 기술과 RF 기술에 추가적으로 고성능 DSP 기술, 인공지능경망 기술 등을 확보하기 위해 연구와 투자를 아끼지 않고 있으며 전 세계적인 반도체 부족 현상에 대응하기 위한 생산의 다원화, 제품의 고도화 등을 통해 고부가가치 사업을 확장해 나가고 있습니다.

[ PKG, TEST 사업 부문(주요종속회사인 (주)원팩) ]

가. 사업의 개요

당사의 종속회사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 공정의 주요한 세부공정 중 패키징 (PKG)과 테스트(TEST)를 포함하는 반도체 후공정 외주사업입니다. 종속회사는 기존 국내 반도체 후공정 업체들이 패키징 사업 또는 테스트 사업으로 양분되어 사업을 진행하고 있는 것과는 달리 두 가지 후공정 분야를 동시에 진행하며, 최종 매출처인 반도체 제조사나 패키징 업체로부터 후공정을 일괄로 수주할 수 있는 기반 인프라를 구축하였습니다.

< 반도체 제조 공정 >

공정		세부설명
전공정	웨이퍼 제조	기둥모양의 단결정을 얇게 잘라 웨이퍼를 만드는 과정
	회로설계	웨이퍼상에 구현될 전자회로를 구성하여 설계하는 과정
	마스크 제작	설계된 전원회로를 각 층별 목적에 따라 나누어 유리마스크에그리는 과정
	웨이퍼 가공	웨이퍼 표면에 여러 종류의 막을 형성하고, 마스크의 사용 특정 부분을 깎아내는 과정을 반복하여 전자회로를 만드는 모든과정 ① 산화 : 800~1200°C의 고온에서 산소 또는 수증기를 웨이퍼 표면과 화학반응 시켜 실리콘 산화막 형성 ② 감광액 도포 : Photo Resist라는 빛에 민감한 물질을 웨이퍼 표면에 균일하게 도포 ③ 노광 : 스테퍼를 사용하여 Mask에 그려진 회로 패턴에 빛을 투과시켜 PR막이 형성된 웨이퍼 위에 회로 패턴 사진 찍음 ④ 현상 : 웨이퍼 표면에서 빛을 받은 부분의 막 현상 ⑤ 식각 : 회로 패턴 형성을 위해 화학물질을 사용하여 불필요한 부분 선택적으로 제거 ⑥ 이온주입 : 회로 패턴과 연결된 부분에 미세한 불순물을 가속하여 웨이퍼 내부에 침투시켜 전자 소자 특성 만들어줌 ⑦ 증착 : 가스 간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착하여 절연막 또는 전도성막 형성 ⑧ 금속배선 : 웨이퍼 표면에 형성된 각 회로를 알루미늄선으로 연결하는 공정
후공정	패키징(PKG)	웨이퍼 상의 Chip을 개개로 절단하여 전기적인 연결을 해주고, 외



		부의 충격에 견디도록 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖게 해주는 과정 ① 웨이퍼 절단 : 웨이퍼 상의 Chip을 다이아몬드 톱으로 절단하여 날개로 분리 ② 금속 연결 : Chip 내부의 외부연결단자와 substrate를 금선으로 연결 ③ 성형 : Chip과 연결 금선 부분을 보호하기 위해 화학 수지로 밀봉
	테스트(TEST)	반도체 소자의 전기적(electrical) 기능을 검사

중속회사가 영위하고 있는 패키징 공정은 반도체 칩을 PCB 등의 substrate에 탑재하여 전기적 신호를 연결해주고 외부 불순물로부터 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖추게 해주는 공정을 말합니다. 기존의 패키징은 반도체 칩이 오류가 나지 않고, 설계시 계획한 대로 작동이 되도록 조립만 하는 단순 공정이었으나 최근 전자제품의 경박단소화, 다기능화 추세에 따라 고객사들도 패키징의 소형화 및 고집적화를 요구하고 있어 지속적인 기술개발이 동반되어야 하는 기술집약적인 공정으로 변화하였습니다.

테스트 공정은 반도체를 최종 출하하기 전에 기능이 제대로 발휘되는지 이상유무를 확인하는 공정으로 테스트 장비와 소프트웨어를 사용하여 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 공정입니다. 기존에는 오류의 유무만 검사하는 단순 공정이었으나 최근 반도체 칩의 내/외관 검사기능은 물론 여러가지 분석업무를 통해 웨이퍼 설계나 가공단계에서의 수율개선에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

반도체 후공정 산업은 반도체 산업초기 종합 반도체 제조업체(IDM)들이 생산 물량의 일정 부분을 할당하는 외주사업으로 시작하였으나, 반도체 기술이 점차 고도화되고 변화의 속도가 빨라지면서 기술개발과 투자에 대한 부담감 등으로 종합 반도체 제조업체(IDM)들은 외주비중을 전략적으로 증가시키기 시작하였습니다.

반면 후공정 전문 외주업체들은 단순 외주에서 탈피하여 기술적으로 진보하는 신규 IT 제품들에 대한 대응을 위해 지속적인 기술 개발과 양산 노하우 확보, 공격적인 투자를 진행한 결과 현재의 기술경쟁력과 생산능력을 확보하게 되었습니다. 이러한 노력을 기반으로 국내뿐만 아니라 해외 주요 종합 반도체 제조업체(IDM), 팹리스(Fabless) 업체들까지 매출처를 확대하며 반도체 연관 산업의 핵심 산업으로 성장하고 있습니다. 또한 최근 종합 반도체 제조업체(IDM)들의 투자가 전공정을 중심으로 진행됨에 따라 후공정에 대한 외주비중은 점차 증가하고 있어 전반적인 시장규모도 확대되고 있습니다.

후공정 산업은 고가의 장비에 대한 투자가 선행되어야만 양산이 가능하고 양산능력 확대 또한 추가 장비 구매에 의해 가능한 장치산업입니다. 이러한 장치산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 사업의 확장을 위해서도 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 투자비용 부담과 함께 패키징 기술, 프로그램 기술 등의 기술개발능력, 양산능력, 품질안정화 등에 대한 기반을 확보하여야 합니다.

또한 중속회사는 지속적인 투자와 연구개발로 기존 메모리 반도체 시장 이외에 빠른 속도로 성장하고 있는 시스템 반도체 시장으로의 사업영역 확장을 위해 노력하고 있으며, 모회사 티엘아이를 기반으로 시스템 반도체 테스트 양산 및 신규 거래선 확보 등을 통하여 사업영역을

점진적으로 확장하기 위해 노력하고 있습니다.

## 나. 업계의 현황

### (1) 후공정시장 동향

반도체 시장이 성장하면서 이에 따른 사업 영역도 점차 확대, 세분화되고 있습니다. 초기 종합 반도체 제조사들은 대규모의 자금력을 바탕으로 반도체 소자생산의 제작과 설계, 생산과 후공정까지 자체적으로 진행하였습니다. 당시 종합 반도체 제조사들은 높은 수익성을 확보하고 있었고 이를 기반으로 전공정 뿐만 아니라 후공정까지 지속적인 투자를 진행하면서 내부적으로 모든 공정을 수행하였습니다.

그러나 점차 반도체 기술 진화는 빠른 속도로 진행되는 반면 단가의 하락이 지속되면서 설비 투자와 연구개발에 대한 리스크 및 원가절감에 대한 부담이 증가하고 이로 인해 산업의 전문화, 세분화의 필요성이 대두되기 시작했습니다. 이는 반도체 설계 전문업체인 팹리스(Fabless), 생산 전문업체인 파운드리(Foundry), 패키징과 테스트 공정을 전문적으로 하는 후공정 전문업체들을 탄생시키는 계기가 되었습니다.

종합 반도체 제조사들은 초기에는 설계에 대한 기술 유출 등을 사유로 외주 비중 자체를 최소한으로 유지하였으나 반도체 가격 하락으로 수익성이 악화됨에 따라 원가절감을 위해 전문 외주업체를 활용하는 비중은 점차 증가해왔습니다.

또한 제품의 특성상 라이프 사이클이 짧고 수급변동으로 인한 판가의 변화에 따라 업황의 사이클이 나타나는 변동주기를 겪으면서 반도체 제조사들은 고정비 감소와 핵심 경쟁력 향상을 위해 반도체 설계와 칩 생산 등의 전공정 단계에 집중하고 있어 향후 외주비중은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

반도체 패키징 및 테스트 시장의 아웃소싱 경향이 이와 같이 가속화되는 또 다른 이유는 더욱 작고 얇은 반도체 칩으로 많은 기능을 빠른 속도로 안정적으로 구현할 것을 요구 받게 됨에 따라 패키징 및 테스트 기술력이 반도체 칩의 성능에 있어서 결정적인 역할을 담당하게 되었기 때문입니다.

반도체 칩의 성능이 개선되어도 외부로 전기적 신호를 전달하는 패키징 기술이 따라오지 못한다면 반도체 칩은 제기능을 수행할 수 없습니다. 산업 초기 회로의 선폭을 줄이는 것이 반도체 칩의 경박단소를 가능하게 하는 유일한 방법이었으나 기술적으로 회로의 선폭을 줄이는 것이 한계에 달함에 따라 패키징을 통한 칩의 경박단소화가 주목받기 시작했습니다.

선폭을 더 줄이는 것이 기술적으로 완전 불가능한 것은 아니지만, 이를 위해 장비와 공정 개선에 투입되는 비용이 큰 폭으로 증가하게 되기 때문에 양산 가능하더라도 경제성이 현저히 떨어진다는 문제점이 존재합니다. 따라서 최근에는 반도체 칩 설계단계가 아닌 패키징 단계에서 이를 해결하려는 노력이 진행되고 있습니다.

또한 테스트 공정 역시 단순 양품/불량제품을 선별하는 것이 아니라 여러가지 분석 업무를 통해 웨이퍼 설계나 가공 단계에서의 수율 개선에 있어 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 사유로 과거에는 전공정에 비하여 상대적으로 낮은 수준의 기술로 여겨졌던 반도체 패키징과 테스트 공정기술의 중요성이 점점 부각되고 있으며, 다년간의 경험을 바탕으로 기술력을 축적해온 외주전문업체들이 각광을 받고 있습니다.

#### ① 패키징 시장

패키징이란 반도체 칩을 PCB 등의 substrate에 탑재하여 전기적 신호를 연결해주고외부 불순물로부터 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖추게 해주는 공정을 말합니다. 일반적으로 패키징 업체들은 반도체 제조사에서 받은 웨이퍼를 연마하고 절단하는 작업부터 패키징까지를 주로 수행하며 패키징이 완료된 제품은 다시 반도체 제조사로 옮겨져 테스트와 모듈화를 거쳐 다양한 최종 수요처에 공급됩니다.

기존의 패키징은 반도체 칩이 오류가 나지 않고, 설계시 계획한 대로 작동이 되도록 조립만 하는 단순 공정이었으나 최근 전자제품의 경박단소화, 다기능화 추세에 따라 고객사들도 패키징의 소형화 및 고집적화를 요구하고 있어 지속적인 연구/기술개발이 동반되어야 하는 기술집약적인 공정으로 변화하였습니다.

최근 반도체 산업의 중심축이 기존 PC에서 스마트폰, 태블릿 PC 등 신형 IT 제품들로 이동하면서 패키징 기술 역시 동반하여 진화하고 있습니다.

기존 PC 용 패키징의 경우 넓은 면적의 PCB 기판에 메모리 칩을 부착하는 구조로 형성되었기 때문에 많은 비용을 투자해 반도체의 두께나 PCB 기판의 면적을 줄여야하는 필요성이 크지 않았습니다.

그러나 휴대폰이나 태블릿 PC 등 신형 IT 제품들은 고성능화 및 경박단소화 되면서 고성능의 칩 기능을 극대화 시키고 실장면적을 최소화 시키는 효율적인 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있습니다.

특히 경박단소화 되는 경향에 맞춰 제한된 공간에 반도체를 장착하여야 하므로 얇은 두께가 필수적으로, 얇고 작게 패키징하여 집적도를 늘리기 위한 적층 패키징 기술의 중요성이 부각되고 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

## ② 테스트 시장

테스트 공정은 반도체를 사용하기 전에 기능을 제대로 발휘하는지 이상유무를 확인하는 것으로 테스트 장비와 소프트웨어를 사용하여 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 공정입니다. 기존에는 오류의 유무만 검사하는 단순 공정이었으나 최근 반도체 칩의 내/외관 검사 기능은 물론 여러가지 분석업무를 통해 웨이퍼 설계나 가공단계에서의 수율개선에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

초기 테스트 외주산업은 대만이나 싱가포르에서 발전하기 시작하여 국내에서는 SK하이닉스가 2000년대 중반 이후 외주비중을 본격적으로 확대시켰고 최근에는 삼성전자의 테스트 외주 비중 확대도 본격화 되고 있습니다.

초기에는 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해 반도체 제조사들은 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피하였습니다. 하지만 2000년 이후 반도체 제조업체들의 투자규모 확대에 따른 리스크 분산 그리고 원가절감차원에서 저가 제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁이 시작되었습니다. 최근에는 반도체 제품의 싸이클이 짧아지고, 신규 IT 모바일 기기들의 등장으로 종합반도체 업체들이 후공정의 외주비중을 증가시키는 추세에 있으며, 팹리스 업체들이 급부상 함으로써 공정의 전문화가 대두되면서 점차 성장하고 있습니다.

장치산업의 특성상 대규모 투자가 동반되어야 하기 때문에 TEST 전문 업체들은 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 또한 관련 매출이 장비 사용 시간을 기준으로 매출 단가가 책정되기 때문에 미세 공정 전환에 따라 제품의 테스트 시간이 길어지는 최근 추세는 출하량 증가와 더불어 테스트 외주업체에는 외형성장의 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

## (2) 대체시장의 현황

중속회사가 영위하고 있는 반도체 패키징 및 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다.

다만 종합반도체 제조업체들이 외주 전문 업체들을 이용하지 않고 패키징 및 테스트 공정을 자체적으로 수행한다면, 당사가 영위하고 있는 후공정 외주시장은 축소될 수 있습니다. 하지만 앞서 언급한 바와 같이 패키징과 테스트 공정을 내재화 하기 위해서는 기술력 증진을 위한 인력조달은 물론이며, 생산력 증대를 위한 막대한 자금이 지속적으로 투자가 되어야 하기 때문에, 현실적으로 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

### 다. 회사의 영업 및 생산

#### (1) 지속적인 연구/개발을 통한 고부가가치 제품 집중 전략

중속회사는 시장변화에 따라 수익성이 낮고, 시장점유율이 퇴조하는 제품의 영업 및 생산은 지양하고 부가가치가 높은 제품 위주의 제품 개발과 영업으로 수익을 창출하고 있으며, 신규 패키징기술 개발을 통해 신제품 수주에 집중하고 있습니다.

중속회사는 차세대 패키징 제품들의 시장 선점을 위해 MCP(Multi Chip Package)을 활용한 High-end 반도체 패키징기술 개발 및 생산 역량 강화에 집중하고 있습니다.

MCP의 경우 18 Stack의 적층 기술을 보유하고 있으며 우수한 적층 기술을 더욱 발전시키는 한편 지속적인 보완투자를 통하여 매출증대 전략을 수립하고 있습니다. 또한 적층기술 뿐만 아니라 얇은 패키지 조립을 위한 Wafer thin grinding기술, 설계기술, 다양한 MCP의 접합기술 등을 지속적으로 연구, 개발 중에 있습니다.

#### (2) 사업영역 확대를 통한 영업전략

시스템 반도체는 다품종 소량 생산으로 수요자의 다양한 요구에 신속하게 대응하기 위해 TV, PC, 모바일 기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되었습니다. 이에 따라 각기 다른 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문업체의 필요성이 더욱 대두되고 있으며 이런 시장환경에 맞추어 고객별 Needs를 정확히 파악하여 이에 맞는 개발을 통하여 영업을 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.

또한, 중속회사는 사업영역의 확장 및 거래선 다변화를 위하여 기존 메모리반도체에서 시스템반도체로 사업영역을 확장해 나아가고 있으며, 최대주주 어보브반도체를 기반으로 시스템반도체 양산 및 신규 거래서 확보 등을 통하여 사업영역을 점진적으로 확장해 나아가고 있습니다.

시스템 반도체 테스트 사업이 활성화 되면 당사는 여러 팹리스 업체들의 칩을 패키징부터 테스트까지 일괄 수주하여 진행할 수 있는 기반을 확보하게 됩니다.

#### (3) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 패키징과 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으나, 공신력있는 기관에서 생성한 시장점유율이 존재하지 않습니다. 또한 경쟁회사의 공시자료에는 메모리반도체와 시스템반도체 매출액이 구분이 불명확하고 제품의 구성도 다양하여 점유율을 산정하기가 불가능하여 시장점유율은 기재하지아니 합니다.



### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

당사는 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 당사의 제18기 3분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

##### (1) 요약연결재무정보

(단위: 원)

구 분	제18기 3분기	제17기	제16기
	2023년 3분기	2022년	2021년
[유동자산]	126,994,890,736	127,473,142,993	58,830,567,677
현금및현금성자산	50,674,428,880	20,717,623,910	7,288,235,212
기타유동금융자산	5,158,500	4,876,500	2,004,560,900
당기손익공정가치측정금융자산	-	-	3,506,628,809
매출채권	23,820,054,399	31,141,073,258	20,594,143,817
기타채권	5,201,734,882	4,754,210,231	3,512,089,126
재고자산	42,932,331,812	66,540,258,624	16,936,902,007
기타유동자산	4,361,182,263	4,315,100,470	4,988,007,806
[비유동자산]	191,928,116,341	204,058,420,155	75,181,356,611
당기손익공정가치측정금융자산	2,203,823,306	2,163,823,306	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002,210	1,200,002,210	4,720,534,249
기타비유동금융자산	2,609,479,972	3,025,603,216	3,248,758,269
관계기업투자	5,892,345,407	6,667,416,620	46,161,565,945
유형자산	137,707,965,449	146,466,371,441	2,263,771,303
무형자산	23,544,542,350	25,904,100,103	8,892,226,141
사용권자산	2,503,480,762	2,128,682,729	422,032,966
순확정급여자산	-	100,240,688	-
기타비유동자산	348,194,659	889,620,568	915,335,523
이연법인세자산	15,918,282,226	15,512,559,274	8,557,132,215
<b>자산총계</b>	<b>318,923,007,077</b>	<b>331,531,563,148</b>	<b>134,011,924,288</b>
[유동부채]	117,595,608,104	127,749,153,276	20,457,920,197
[비유동부채]	41,693,178,900	30,713,825,579	1,725,243,833
<b>부채총계</b>	<b>159,288,787,004</b>	<b>158,462,978,855</b>	<b>22,183,164,030</b>
[지배기업소유주지분]	117,126,139,489	120,769,541,251	111,828,760,258
자본금	8,890,376,500	8,890,376,500	8,729,826,500
자본잉여금	26,421,638,151	26,421,998,151	23,084,044,791
기타자본항목	(997,685,787)	(7,414,053,960)	(4,477,193,500)
기타포괄손익누계액	(779,119,799)	(676,650,161)	151,459,276

이익잉여금(결손금)	83,590,930,424	93,547,870,721	84,340,623,191
[비지배지분]	42,508,080,584	52,299,043,042	-
<b>자본총계</b>	<b>159,634,220,073</b>	<b>173,068,584,293</b>	<b>111,828,760,258</b>
<b>부채 및 자본총계</b>	<b>318,923,007,077</b>	<b>331,531,563,148</b>	<b>134,011,924,288</b>
매출액	172,313,566,090	242,576,796,583	167,498,755,290
영업이익	(11,414,241,238)	25,825,288,073	17,622,418,239
법인세비용차감전순이익(손실)	(17,785,616,736)	14,380,083,677	15,039,278,590
당기순이익(손실)	(16,448,151,954)	12,654,577,621	13,707,442,319
지배기업의 소유지분	(6,657,189,497)	12,447,173,980	13,707,442,319
비지배지분	(9,790,962,457)	207,403,641	-
총포괄손익	(16,550,621,592)	12,558,737,574	14,085,999,193
지배기업의 소유지분	(6,759,659,135)	12,447,173,980	14,085,999,193
비지배지분	(9,790,962,457)	207,403,641	-
기본 주당순이익(원)	(997)	770	828
희석 주당순이익(원)	(996)	769	828
연결에 포함된 회사수	3	3	1

(2) 요약별도재무정보

(단위: 원)

구 분	제18기 3분기	제17기	제16기
	2023년 3분기	2022년	2021년
[유동자산]	102,246,642,125	99,572,141,152	58,836,727,086
현금및현금성자산	36,077,432,286	15,866,024,139	5,759,130,745
기타유동금융자산	-	-	2,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	-	-	3,506,628,809
매출채권	22,575,157,029	23,854,682,081	23,151,951,364
기타채권	4,096,805,473	4,257,293,452	3,474,942,648
재고자산	35,922,254,991	51,499,369,249	16,152,528,489
기타유동자산	3,574,992,346	4,094,772,231	4,791,545,031
[비유동자산]	84,642,389,484	83,105,671,428	74,156,495,080
당기손익공정가치측정금융자산	2,203,823,306	2,163,823,306	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002,210	1,200,002,210	4,720,534,249
기타비유동금융자산	1,657,102,733	2,554,763,966	3,207,841,788
종속기업 및 관계기업 투자	53,928,196,652	51,912,606,602	45,301,145,340
유형자산	3,988,365,444	4,291,763,833	2,193,381,481
무형자산	9,131,248,216	8,243,381,617	8,892,226,141
사용권자산	1,672,864,465	1,039,871,676	368,898,343
순확정급여자산	-	101,918,204	-
기타비유동자산	304,775,751	889,620,568	915,335,523
이연법인세자산	10,556,010,707	10,707,919,446	8,557,132,215
<b>자산총계</b>	<b>186,889,031,609</b>	<b>182,677,812,580</b>	<b>132,993,222,166</b>
[유동부채]	54,048,369,535	54,975,631,091	20,275,502,180
[비유동부채]	2,806,278,893	1,452,018,688	1,717,492,668
<b>부채총계</b>	<b>56,854,648,428</b>	<b>56,427,649,779</b>	<b>21,992,994,848</b>
[자본금]	8,890,376,500	8,890,376,500	8,729,826,500
[자본잉여금]	26,421,998,151	26,421,998,151	23,084,044,791
[기타자본항목]	(6,682,133,986)	(7,405,033,999)	(4,468,173,539)
[기타포괄손익누계액]	(430,022,155)	(430,022,155)	446,166,025
[이익잉여금(결손금)]	101,834,164,671	98,772,844,304	83,208,363,541
<b>자본총계</b>	<b>130,034,383,181</b>	<b>126,250,162,801</b>	<b>111,000,227,318</b>
<b>부채 및 자본총계</b>	<b>186,889,031,609</b>	<b>182,677,812,580</b>	<b>132,993,222,166</b>
<b>종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법</b>	<b>원가법</b>	<b>원가법</b>	<b>원가법</b>
매출액	102,933,270,238	194,285,575,665	159,785,908,613
영업이익	9,537,628,416	28,532,465,744	16,521,093,559
법인세비용차감전순이익(손실)	7,060,012,394	20,274,940,386	14,264,133,114



당기순이익(손실)	6,361,071,167	18,804,407,213	13,186,144,599
총포괄손익	6,361,071,167	18,660,488,423	13,558,050,852
기본 주당순이익(원)	386	1,145	797
희석 주당순이익(원)	385	1,143	796

## 2. 연결재무제표

### 2-1. 연결재무상태표

#### 연결 재무상태표

제 18 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 17 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기말	제 17 기말
자산		
유동자산	126,994,890,736	127,473,142,993
현금 및 현금성자산	50,674,428,880	20,717,623,910
기타유동금융자산	5,158,500	4,876,500
매출채권	23,820,054,399	31,141,073,258
기타채권	5,201,734,882	4,754,210,231
재고자산	42,932,331,812	66,540,258,624
기타유동자산	4,361,182,263	4,315,100,470
비유동자산	191,928,116,341	204,058,420,155
당기손익공정가치측정금융자산	2,203,823,306	2,163,823,306
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002,210	1,200,002,210
기타비유동금융자산	2,609,479,972	3,025,603,216
관계기업투자주식	5,892,345,407	6,667,416,620
유형자산	137,707,965,449	146,466,371,441
무형자산	23,544,542,350	25,904,100,103
사용권자산	2,503,480,762	2,128,682,729
순확정급여자산		100,240,688
이연법인세자산	15,918,282,226	15,512,559,274
기타비유동자산	348,194,659	889,620,568
자산총계	318,923,007,077	331,531,563,148
부채		
유동부채	117,595,608,104	127,749,153,276
매입채무	10,918,426,512	24,530,336,251
기타채무	8,459,785,635	17,989,046,161
단기차입금	81,586,000,000	62,238,339,073
유동성장기차입금	10,764,936,885	13,451,199,909
유동성전환사채	4,651,937,609	4,311,792,535

유동성리스부채	1,030,438,493	968,281,241
당기법인세부채	(715,936,928)	3,090,465,284
기타 유동부채	900,019,898	1,169,692,822
비유동부채	41,693,178,900	30,713,825,579
장기차입금	29,723,380,324	28,845,885,868
비유동리스부채	1,139,578,890	865,194,963
기타비유동금융부채	477,629,006	455,599,508
순확정급여채무	988,867,572	
사채	8,744,214,723	
기타비유동부채	619,508,385	547,145,240
부채총계	159,288,787,004	158,462,978,855
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	117,126,139,489	120,769,541,251
자본금	8,890,376,500	8,890,376,500
자본잉여금	26,421,638,151	26,421,998,151
기타자본항목	(997,685,787)	(7,414,053,960)
기타포괄손익누계액	(779,119,799)	(676,650,161)
이익잉여금(결손금)	83,590,930,424	93,547,870,721
비지배지분	42,508,080,584	52,299,043,042
자본총계	159,634,220,073	173,068,584,293
자본과부채총계	318,923,007,077	331,531,563,148

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

### 연결 포괄손익계산서

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기		제 17 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	51,348,709,720	172,313,566,090	45,570,009,767	164,802,326,879
제품매출액	50,368,266,672	169,621,705,590	45,521,251,839	164,602,921,697
상품매출액	980,443,048	2,691,860,500	48,757,928	199,405,182
매출원가	50,249,048,084	163,731,307,412	35,004,236,889	117,890,905,554
제품매출원가	49,306,964,731	161,172,388,864	34,982,587,371	117,702,786,255
상품매출원가	942,083,353	2,558,918,548	21,649,518	188,119,299
매출총이익	1,099,661,636	8,582,258,678	10,565,772,878	46,911,421,325
판매비와관리비	6,128,211,997	19,996,499,916	5,308,787,012	24,318,982,291
영업이익(손실)	(5,028,550,361)	(11,414,241,238)	5,256,985,866	22,592,439,034
금융수익	1,326,685,696	4,430,118,239	1,535,360,279	3,120,886,593
금융비용	2,658,100,549	8,546,448,135	3,461,268,081	4,846,192,276

기타수익	(17,489,106)	1,983,212,514	1,784,835,012	2,403,762,921
기타비용	1,655,209,292	4,238,258,116	569,228,093	2,066,239,187
법인세비용차감전순이익(손실)	(8,032,663,612)	(17,785,616,736)	4,546,684,983	21,204,657,085
법인세비용(수익)	(1,643,905,330)	(1,337,464,782)	490,434,736	2,189,953,586
당기순이익(손실)	(6,388,758,282)	(16,448,151,954)	4,056,250,247	19,014,703,499
기타포괄손익	(61,980,364)	(102,469,638)	361,697,488	(884,876,800)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		2,828,693	413,213,243	(857,004,006)
순확정급여부채의 재측정요소			413,213,243	(18,324,260)
지분법 자본변동		2,828,693		
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익				(838,679,746)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(61,980,364)	(105,298,331)	(51,515,755)	(27,872,794)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(61,980,364)	(105,298,331)	(51,515,755)	(27,872,794)
총포괄손익	(6,450,738,646)	(16,550,621,592)	4,417,947,735	18,129,826,699
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유지분	(2,929,247,066)	(6,657,189,497)	4,056,250,247	19,014,703,499
비지배지분	(3,459,511,216)	(9,790,962,457)		
포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유지분	(2,991,227,430)	(6,759,659,135)	4,417,947,735	18,129,826,699
비지배지분	(3,459,511,216)	(9,790,962,457)		
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(387)	(997)	249	1,159
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(387)	(996)	249	1,157

### 2-3. 연결 자본변동표

#### 연결 자본변동표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2022.01.01 (기초자본)	8,729,826,500	23,084,044,791	(4,477,193,500)	151,459,276	84,340,623,191	111,828,760,258		111,828,760,258
당기순이익(손실)					19,014,703,499	19,014,703,499		19,014,703,499
유상증자	160,550,000	3,337,953,360				3,498,503,360		3,498,503,360
금융자산의 재분류 효과				(838,679,746)	765,358,950	(73,320,796)		(73,320,796)
배당금의 지급					(3,972,195,840)	(3,972,195,840)		(3,972,195,840)
자기주식의(취득)처분			(4,993,987,200)			(4,993,987,200)		(4,993,987,200)
주식매입선택권			1,191,756,768			1,191,756,768		1,191,756,768
순확정급여부채의 재측정요소					(18,324,260)	(18,324,260)		(18,324,260)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익								(884,876,800)
지분법 자본변동								
해외사업환산손익				(27,872,794)		(27,872,794)		(27,872,794)
전환권대가								

신주인수권대가								
2022.09.30 (기말자본)	8,890,376,500	26,421,998,151	(8,279,423,932)	(715,093,264)	100,130,165,540	126,448,022,995		126,448,022,995
2023.01.01 (기초자본)	8,890,376,500	26,421,998,151	(7,414,053,960)	(676,650,161)	93,547,870,721	120,769,541,251	52,299,043,042	173,068,584,293
당기순이익(손실)					(6,657,189,497)	(6,657,189,497)	(9,790,962,457)	(16,448,151,954)
유상증자		(360,000)				(360,000)		(360,000)
금융자산의 재분류 효과								
배당금의 지급					(3,299,750,800)	(3,299,750,800)		(3,299,750,800)
자기주식의(취득)처분								
주식매입선택권			723,398,664			723,398,664		723,398,664
순확정급여부채의 재측정요소								
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익								(102,469,638)
지분법자본변동				2,828,693		2,828,693		2,828,693
해외사업환산손익				(105,298,331)		(105,298,331)		(105,298,331)
전환권대가			4,269,727,132			4,269,727,132		4,269,727,132
신주인수권대가			1,423,242,377			1,423,242,377		1,423,242,377
2023.09.30 (기말자본)	8,890,376,500	26,421,638,151	997,685,787	779,119,799	83,590,930,424	117,126,139,489	42,508,080,584	159,634,220,073

2-4. 연결 현금흐름표  
연결 현금흐름표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지  
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기	제 17 기 3분기
영업활동현금흐름	14,961,435,690	5,313,444,211
당기순이익(손실)	(16,448,151,954)	19,014,703,499
조정	28,167,585,922	13,473,489,926
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	9,535,842,900	(24,683,741,818)
이자수취	847,338,363	260,074,951
이자지급(영업)	(4,173,366,287)	(95,328,863)
법인세환급(납부)	(2,967,813,254)	(2,655,753,484)
투자활동현금흐름	(12,825,928,471)	(2,651,284,600)
장단기금융상품의 처분	(478,443,891)	4,000,000,000
장단기금융상품의 취득		(2,000,000,000)
당기손익공정가치 측정금융자산 취득	40,000,000	
당기손익공정가치 측정금융자산 처분		895,691,883
보증금의 감소	745,213,070	442,128,731
보증금의 증가	(737,273,333)	(1,750,057,683)
유형자산의 취득	(9,148,193,630)	(2,787,760,504)
유형자산의 처분	1,822,284,631	169,636,362
무형자산의 취득	(3,717,913,154)	(2,138,388,287)

무형자산의 처분	636,363,637	
회원권의 취득		
국고보조금의 취득	61,923,766	178,562,635
국고보조금의 감소		(18,324,376)
대여금의 감소	31,110,433	63,929,344
대여금의 증가		(15,000,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득		(891,704,915)
관계기업투자주식의 취득	2,001,000,000	
관계법인 투자주식의 처분		1,200,002,210
재무활동현금흐름	27,397,255,400	6,542,924,895
단기차입금의 차입	18,406,819,856	24,241,600,000
단기차입금의 상환		(11,424,600,000)
유동성장기차입금의 상환	(11,535,418,568)	
장기차입금의 차입	10,000,000,000	
신주인수권부사채의 증가	11,880,000,000	
전환사채의 증가	3,960,000,000	
장기차입금의 상환	(833,350,000)	
자기주식의 취득		(4,993,987,200)
리스부채의 감소	1,181,045,088	806,395,425
배당금의 지급	(3,299,750,800)	(3,972,195,840)
유상증자		3,498,503,360
현금및현금성자산의 증감	29,532,762,619	9,205,084,506
기초현금및현금성자산	20,717,623,910	7,288,235,212
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	424,042,351	(222,054,220)
기말현금및현금성자산	50,674,428,880	16,271,265,498

### 3. 연결재무제표 주식

제 18(당)기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지

제 17(전)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

어보브반도체 주식회사와 그 종속기업

#### 1. 연결회사의 개요

##### (1) 지배기업의 개요

어보브반도체 주식회사(이하 "지배회사")와 그 종속기업(이하 지배회사와 종속기업을 합하

여 "연결회사")은 비메모리반도체(MCU)를 개발하여 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 지배회사는 2006년 1월 11일 설립되었으며, 본점의 소재지는 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93입니다.

지배회사는 2009년 6월 5일 주식을 KOSDAQ 시장에 상장하였으며, 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 납입자본금은 8,890백만원입니다.

당분기말 현재 연결회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)
최원	3,315,643	18.65%
(주)그린칩스홀딩스	444,648	2.50%
자기주식	1,281,999	7.21%
기타	12,738,463	71.64%
합계	17,780,753	100.00%

(2) 연결대상 종속기업 개요

가. 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)		소재지	결산월	업종
	당분기말	전기말			
ABOV SEMICONDUCTOR (HK) CO LTD	100.00	100.00	홍콩	12월	비메모리반도체 판매
ABOV SEMICONDUCTOR VINA COMPANY LIMITED(*1)	100.00	100.00	베트남	12월	반도체 설계 용역
(주)원택	38.31	38.31	한국	12월	반도체 후공정 제조

나. 당분기 및 전분기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

< 당분기 >

(단위 : 천원)

회사명	당분기말		당분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
ABOV SEMICONDUCTOR (HK) CO LTD	7,003,613	9,607,275	10,192,624	(116,020)	26,867,874	(1,479,033)
ABOV SEMICONDUCTOR VINA COMPANY LIMITED	509,102	201,620	173,982	26,712	518,471	178,548
(주)원택	167,367,617	102,752,533	18,483,792	(6,060,717)	67,153,235	(17,229,663)

< 전분기 >

(단위 : 천원)

회사명	전분기말		전분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
ABOV SEMICONDUCTOR (HK) CO LTD	9,381,300	9,743,704	8,011,822	(916,109)	37,635,728	(897,932)
ABOV SEMICONDUCTOR VINA COMPANY LIMITED(*1)	120,360	-	-	-	-	-

## 2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

연결회사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표로서 종속기업 및 관계기업투자자산에 대해서 원가법을 적용하고 있습니다.

### 2.1.1 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

#### (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

동 개정사항은 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가 손익 공시

동 개정사항은 자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 연결회사가 발행한 해당 금융상품의 정보는 주식 14에 공시하였습니다.

#### (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

동 개정사항은 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

동 개정사항은 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

### 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.



(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

## 2.2 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주식 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

### 2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

## 3. 중요한 회계추정 및 가정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영자는 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결회사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영자가 내린 중요한 판단은 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

#### 4. 금융위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

요약분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

## 5. 현금 및 현금성자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 현금 및 현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	29,600	20,346
보통예금	33,948,077	19,209,516
외화예금	16,696,752	1,487,762
합 계	50,674,429	20,717,624

## 6. 금융상품

### (1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<b>금융자산</b>				
현금및현금성자산	50,674,429	(*2)	20,717,624	(*2)
기타유동금융자산	5,159	(*2)	4,877	(*2)
매출채권	23,820,054	(*2)	31,141,072	(*2)
기타채권(*1)	4,474,540	(*2)	2,250,859	(*2)
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	2,203,823	2,203,823	2,163,823	2,163,823
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002
기타비유동금융자산	2,609,480	(*2)	3,025,603	(*2)
<b>금융부채</b>				
매입채무	10,918,427	(*2)	24,530,336	(*2)
기타채무(*2)	2,962,479	(*2)	11,122,909	(*2)
단기차입금	81,586,000	(*2)	62,238,339	(*2)
유동성장기차입금	10,764,937	(*2)	13,451,200	(*2)
유동성전환사채	4,651,938	(*2)	4,311,793	(*2)
장기차입금	29,723,380	(*2)	28,845,886	(*2)
기타비유동금융부채	477,629	(*2)	455,600	(*2)
<b>리스부채</b>				
리스부채(유동)	1,030,438	(*2)	968,281	(*2)
리스부채(비유동)	1,139,579	(*2)	865,195	(*2)

(\*1) 금융상품에 해당하지 않는 종업원, 체세금은 제외하였습니다.

(\*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.

(2) 공정가치 서열체계

연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
수준 3	직·간접적으로 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치

당분기말 및 전기말 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	1,200,002	1,200,002
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	-	-	2,203,823	2,203,823
파생상품부채	-	-	43,772	43,772

<전기말>

(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	1,200,002	1,200,002
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	-	-	2,163,823	2,163,823
파생상품부채	-	-	76,618	76,618

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있으며, 출자형태의 집합투자회사는 분기별 투자내역 및 투자 실적의 평가가 반영된 보고서를 통해 평가하고 있습니다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(3) 당기손익공정가치측정금융자산

당분기말 및 전기말 현재 당기손익공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	종류	주식수	지분율	당분기말		전기말	
				장부가액	공정가액	장부가액	공정가액
메가RS투자조합	조합출자금	835	5.00%	1,166,623	1,166,623	1,166,623	1,166,623
주식회사 씨니웨이브텍	상환전환우선주	38,780	9.07%	997,200	997,200	997,200	997,200
혁신 IP 기술사업화 투자조합(*1)	조합출자금	40	0.33%	40,000	40,000	-	-
합계				2,203,823	2,203,823	2,163,823	2,163,823

(\*1) 당기 6월 혁신 IP 기술사업화 투자조합에 출자를 결정하였으며, 출자금 40백만원 출자하여, 투자조합에 대한 0.33%의 지분율을 획득하였습니다.

(4) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주, %)

회사명	종류	주식수	지분율	당분기말		전기말	
				장부가액	공정가액	장부가액	공정가액
관악아날로그㈜	보통주	55,550	7.14%	1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002
합계				1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002

7. 매출채권 및 기타채권과 기타비유동금융자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 매출채권 및 기타채권과 기타비유동금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
유동			
매출채권	매출채권	24,038,457	31,204,416
	대손충당금	(218,402)	(63,343)
	합 계	23,820,055	31,141,073
기타채권	미수수익	144,326	144,326
	미수금	2,538,370	2,884,673
	대손충당금	(277,786)	(277,786)
	유동성임차보증금	2,720,000	1,927,639
	단기대여금	1,088,824	1,087,358

	대손충당금	(1,012,000)	(1,012,000)
	합 계	5,201,734	4,754,210
기타금융자산	기타유동금융자산	5,159	4,877
비유동			
기타금융자산	보증금	2,111,702	2,839,858
	현재가치할인차금	(235,726)	(100,425)
	장기미수금	100,000	100,000
	장기금융상품	633,504	155,060
	장기대여금	-	31,110
	합 계	2,609,480	3,025,603

손상된 매출채권에 대한 대손충당금 설정액은 포괄손익계산서상 '대손상각비'에 포함되어 있으며, 기타 상각후원가 측정 금융자산에 대한 대손충당금 설정액은 '기타의 대손상각비'에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 해당 채권과 대손충당금은 제각하고 있습니다.

기타비유동금융자산의 구성내역으로는 리스와 관련한 임차보증금과 임직원대여금으로 구성되어 있으며, 각각 임차자산과 임금채권을 담보하고 있어 기대신용손실의 발생 가능성은 매우 낮습니다.

8. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실 총당금	장부금액	취득원가	평가손실 총당금	장부금액
상품	-	-	-	2,463	(2,463)	-
제품	8,333,104	(744,712)	7,588,392	16,543,158	(1,059,414)	15,483,744
원재료	13,345,812	(910,261)	12,435,551	28,002,140	(900,277)	27,101,863
재공품	24,233,139	(1,324,750)	22,908,389	25,518,181	(1,563,529)	23,954,652
합 계	45,912,055	(2,979,723)	42,932,332	70,065,942	(3,525,683)	66,540,259

(2) 당분기와 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실 및 환입은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가		
재고자산평가손실	-	2,652,936
재고자산평가손실환입	149,549	-



9. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
관계기업 및 공동기업	5,892,345	6,667,417

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	6,667,417	46,161,566
취득	2,001,000	-
처분	-	(1,200,002)
대체	-	(1,200,002)
지분법손익	(2,768,719)	(1,082,745)
지분법자본변동	3,327	(8,183)
지분법처분손익	(10,680)	1,248,879
분기말 장부금액	5,892,345	43,919,513

10. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	146,466,371	2,263,771
일반취득 및 자본적지출	5,620,232	2,772,101
감가상각	(14,223,963)	(497,925)
처분·폐기·손상	(156,610)	(73,535)
기타	1,935	19,013
분기말 장부금액	137,707,965	4,483,425

(2) 당분기와 전분기의 유형자산 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가	13,919,955	312,156
판매비와 관리비	307,223	150,706
합 계	14,227,178	462,862

(3) 사용권자산

① 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	2,128,683	422,033
취득	1,704,326	1,788,797
감가상각	(1,270,787)	(565,769)
처분·폐기·손상	(70,717)	(54,391)
기타	11,976	(9,620)
분기말 장부금액	2,503,481	1,581,050

② 당분기 및 전분기 중 사용권자산 관련 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부가액	1,833,476	371,115
증가	1,520,751	1,587,180

감소	(64,990)	(61,738)
지급	(1,219,735)	(806,395)
이자비용	67,590	54,153
기타	32,925	-
분기말 장부금액	2,170,017	1,144,315

③ 당분기와 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비(매출원가)	806,223	256,048
사용권자산 감가상각비(판매비와 관리비)	461,351	309,721
리스부채 이자비용	67,590	54,153

11. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	25,904,100	8,892,226
취득	4,260,350	10,012,486
감가상각	(5,004,903)	(2,239,665)
처분·폐기·손상	(1,615,005)	83,974
기타	-	(7,884,644)
분기말 장부금액	23,544,542	8,864,377

(2) 당분기와 전분기의 무형자산상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가	2,089,783	2,149,222
판매비와 관리비	2,915,021	90,443
합 계	5,004,804	2,239,665

12. 매입채무 및 기타채무와 기타비유동금융부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 매입채무 및 기타채무와 기타비유동금융부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	
	유동	비유동	유동	비유동
매입채무	10,918,427	-	24,530,335	-
미지급금	2,706,396	477,629	8,611,607	455,600
미지급비용	5,704,617	-	9,295,822	-
임대보증금	5,000	-	5,000	-
파생상품부채	43,772	-	76,618	-
합 계	19,378,212	477,629	42,519,382	455,600

(2) 연결회사의 매입채무 및 기타채무는 주로 단기지급채무로서 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않은 것으로 판단하고 있습니다.

13. 순확정급여채무

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에 인식하는 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
확정급여채무 현재가치	8,987,470	8,588,537
사외적립자산 공정가치	(7,998,602)	(8,688,777)
순확정급여부채(자산)	988,868	(100,240)

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
당기근무원가	1,073,043	954,881
순이자원가(수익)	(56,060)	(13,046)
합 계	1,016,983	941,835

(\*) 당기근무원가와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가	701,849	843,263
판매비와 관리비	315,134	98,572
합 계	1,016,983	941,835

(3) 당분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 1,556,650천원(전분기 : 303,774천원)입니다.

## 14. 차입금 및 전환사채

### (1) 차입금 장부금액의 내역

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동성 차입금:		
단기차입금	81,586,000	62,238,339
유동성장기차입금	10,764,937	13,451,200
소계	92,350,937	75,689,539
비유동성 차입금:		
장기차입금	29,723,380	28,845,886
합계	122,074,317	104,535,425

### (2) 차입금 상세내역

#### 1) 단기차입금

(단위 : 천원)

차입처	연이자율(%)	최장만기연월	당분기말	전기말	비고
한국수출입은행	4.10% ~ 5.50%	2024.04	22,482,400	16,474,900	-
	5.80%	2023.12	2,500,000	2,500,000	(*1)
KDB산업은행	4.49% ~ 6.73%	2024.03	26,413,600	23,013,439	-
	4.17% ~ 5.78%	2024.02	6,000,000	6,000,000	(*1)
KB국민은행	5.68% ~ 6.23%	2024.06	5,000,000	5,000,000	-
	5.15%	2024.04	700,000	-	(*1)
	7.05%	2023.11	2,000,000	2,000,000	(*2)
신한은행	5.85%	2024.04	1,300,000	1,300,000	-
	6.04%	2023.10	600,000	600,000	(*1)
IBK기업은행	5.55%	2024.09	3,000,000	-	(*1)
우리은행	4.62% ~ 5.73%	2024.05	5,115,000	5,350,000	-
KEB하나은행	3.58% ~ 5.08%	2024.03	6,475,000	-	(*1)
합계			81,586,000	62,238,339	-

(\*1) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 토지, 건물 및 기계장치가 담보로 제공되고 있습니다.

(\*2) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 특허권이 담보로 제공되고 있습니다.

2) 장기차입금

(단위 : 천원)

차입처	연이자율(%)	최장만기연월	당분기말	전기말	비고
KDB산업은행	2.60% ~ 2.84%	2027.09	3,333,280	3,958,270	(*1)
	4.87% ~ 4.88%	2025.05	21,500,000	24,000,000	(*2)
KB국민은행	5.68%	2024.06	-	2,209,091	-
	4.70% ~ 5.39%	2025.04	3,211,688	3,000,000	(*1)
우리은행	5.70%	2026.08	3,000,000	-	(*1)
신한은행	5.87%	2024.10	613,889	1,038,889	(*1)
IBK기업은행	6.59%	2026.11	-	1,860,260	-
	5.93% ~ 6.59%	2026.11	4,162,820	3,937,130	(*1)
NH농협	6.34%	2023.09	-	1,499,990	-
	6.15%	2026.01	4,666,640	-	(*1)
KEB하나은행	5.07% ~ 6.40%	2023.08	-	793,456	-
장기차입금			40,488,317	42,297,086	-
차감: 유동성장기차입금			(10,764,937)	(13,451,200)	-
합계			29,723,380	28,845,886	-

(\*1) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산 및 무형자산이 담보로 제공되고 있습니다.

(\*2) 연결회사는 삼성전자 및 SK하이닉스로 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 KDB산업은행과 신탁계약을 체결하였으며, 수익권 을 담보로 대출약정을 하였습니다.

(3) 전환사채 및 신주인수권부사채

당분기말 및 전기말 현재 전환사채 및 신주인수권부 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	발행일	상환일	이자율(%)	당분기말	전기말
제7회 무보증 전환사채	2021년 6월 11일	2024년 6월 11일	0.0%	5,000,000	5,000,000
전환권조정				(373,256)	(662,031)
사채할인발행차금				(13,208)	(26,177)
차감잔액				4,613,536	4,311,792
유동성대체액				(4,613,536)	(4,311,792)

(단위 : 천원)

구분	발행일	상환일	이자율(%)	당분기말	전기말
제8회 무보증 전환사채	2023년 08월 02일	2028년 08월 02일	0.00%	12,000,000	-
상환할증금				1,258,740	-



전환권조정	(6,583,244)	-
사채할인발행차금	(117,335)	-
차감잔액	6,558,161	-
유동성대체액	(6,558,161)	-

(단위 : 천원)

구분	발행일	상환일	이자율(%)	당분기말	전기말
제2회 무보증 신주인수권부사채	2023년 08월 02일	2028년 08월 02일	0.00%	4,000,000	-
상환할증금				419,580	-
전환권조정				(2,194,414)	-
사채할인발행차금				(39,112)	-
차감잔액				2,186,054	-
유동성대체액				(2,186,054)	-

① 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	제7회 무보증 전환사채	제8회 무보증 전환사채	제2회 무보증 신주인수권부사채
발행일	2021년 06월 11일	2023년 08월 02일	2023년 08월 02일
만기일	2024년 06월 11일	2028년 08월 02일	2028년 08월 02일
전환청구기간	2022년 06월 11일 ~ 2024년 05월 11일	2024년 08월 02일 ~ 2028년 07월 02일	2024년 08월 02일 ~ 2028년 07월 02일
이자율	-	-	-
만기수익률	-	2%	2%
행사시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주	기명식 보통주	기명식 보통주
전환가격	1,580	1,743	1,743
조기상환청구권	(*1)	(*3)	(*3)
매도청구권	(*2)	(*4)	(*4)
원금상환방법	만기상환	만기상환	만기상환
발행가격	5,000,000,000원	12,000,000,000원	4,000,000,000원

(\*1) 인수자는 사채발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날부터 이후 매 3개월에 해당하는 날에 동 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put-option)을 행사할 수 있습니다.

(\*2) 매수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날 부터 1년 6개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부(30%)를 매수인에게 매도하여 줄것을 청구 할수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도(Call Option)하여야 합니다.

(\*3) 인수인은 사채발행일로부터 24개월이 경과한 날로부터 이후 매3개월에 해당하는 날에 동 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있습니다.

(\*4) 매수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날 및 발행일 이후 24개월 이 경과한 날 까지의 기간중 매 3개월에 해당되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부(40%)를 매수인에게 매도하여 줄것을 청구할수 있으며, 사채권 자의 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도(Call Option) 하여야 합니다.

② 상기 전환사채와 관련하여 당분기말 및 전기말에 인식된 파생상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
파생상품부채(*)	43,772	76,618

(\*) 상기 파생상품부채는 기타유동금융부채에 포함되어 있습니다.

(4) 제공받은 지급보증

당분기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기관명	보증금액	보증내용
서울보증보험	72,100	채권 가압류 담보(*1)

(\*1) 매출채권 가압류를 위해 공탁보증보험을 가입했습니다.



15. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 연결회사의 수권주식수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 500원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수	17,780,753	17,780,753
보통주 자본금	8,890,377	8,890,377
주식발행초과금	26,421,638	26,421,998
<기타자본항목>		
자기주식	(10,587,739)	(10,587,739)
자기주식처분이익	705,847	705,847
주식선택권	3,200,257	2,476,858
전환권대가	4,269,727	-
신주인수권대가	1,423,242	-
지분법자본변동	(9,020)	(9,020)
기타자본항목 합계	(997,686)	(7,414,054)
자기주식 수	1,281,999	1,281,999

(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 유통주식수는 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구분	당분기말			전기말		
	발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수
발행주식수	17,780,753	1,281,999	16,498,754	17,780,753	1,281,999	16,498,754

16. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
지분법자본변동	15,997	13,168
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(430,022)	(430,022)
해외사업환산손익	(365,094)	(259,796)
합계	(779,119)	(676,650)

## 17. 이익잉여금

(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
법정적립금	2,209,101	1,879,126
보험수리적손익	(373,868)	(373,868)
미처분이익잉여금	81,755,698	92,042,613
합계	83,590,931	93,547,871

### (2) 법정적립금

연결회사의 법정적립금은 이익준비금으로 상법상 연결회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용이 가능합니다.

## 18. 영업부문

연결회사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

### (1) 보고부문의 재무현황

(단위: 천원)

구분	당분기				전분기
	비메모리반도체 (MCU)부문	반도체 후공정 (PKG 및 TEST)부문	조정 및 제거	연결	비메모리반도체(MCU)부문
총매출액	107,482,001	67,153,235	(2,321,669)	172,313,566	164,802,327
영업이익	8,559,044	(17,499,412)	(2,473,873)	(11,414,241)	22,592,439
감가상각비	2,977,536	17,618,138	(96,120)	20,499,554	3,268,296
총자산	183,350,124	170,059,617	(34,486,734)	318,923,007	170,566,268
관계기업투자주식	5,892,345	-	-	5,892,345	43,919,513
이연법인세자산	10,556,011	5,362,271	-	15,918,282	8,505,506
총부채	57,251,861	102,752,533	(715,608)	159,288,787	44,118,245

### (2) 주요 고객별 수익의 구분

당분기와 전분기 중 고객으로부터의 매출액이 연결회사 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
고객A	21,046,860	72,909,509	15,996,554	50,118,372
고객B	-	-	7,511,161	28,539,058

(3) 지역별 정보

당분기 및 전분기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	계정	국내	중국	베트남	내부거래조정	조정후금액
당분기	순매출액	170,086,505	26,867,874	518,471	(25,159,284)	172,313,566
당분기말	비유동자산(*)	146,745,156	212,295	201,118	16,312,110	163,470,679
전분기	순매출액	164,791,307	37,635,728	-	(37,624,709)	164,802,327
전분기말	비유동자산(*)	15,046,729	365,261	-	-	15,411,990

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.



19. 판매비와 관리비

당분기와 전분기 중 연결회사의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	2,524,471	7,607,875	2,126,874	6,514,528
상여금	354,823	386,310	803,527	2,884,791
퇴직급여	140,143	612,268	226,194	402,346
복리후생비	290,937	854,544	167,136	828,244
여비교통비	184,761	372,057	116,535	306,818
감가상각비	32,920	768,574	182,763	460,426
무형자산상각비	971,953	2,915,021	30,702	90,442
세금과공과금	438,230	1,307,552	413,176	1,105,932
운반비	173,777	467,858	240,562	737,277
지급수수료	494,175	2,252,423	224,947	6,556,591
경상연구개발비	145,996	430,503	-	-
주식보상비용	(28,190)	390,617	463,785	745,425
기타	758,245	1,630,898	312,586	3,686,162
합 계	6,482,241	19,996,500	5,308,787	24,318,982

20. 기타수익과 기타비용

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분이익	-	1,667,771	1,636	117,019
무형자산처분이익	-	38,300	-	-
무형자산손상차손환입	-	-	-	103,620
지분법이익	(21,623)	227,903	331,313	686,080
관계기업투자주식처분이익	-	-	1,393,395	1,393,395
수입임대료	1,500	4,500	-	-
잡이익	2,634	44,739	58,491	103,649
합 계	(17,489)	1,983,213	1,784,835	2,403,763

(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
기부금	10,000	79,000	14,284	27,485
유형자산처분손실	-	2,926	-	20,917
무형자산손상차손	1,016,942	1,016,942	32,470	37,970
지분법손실	617,336	2,996,622	738,824	1,858,825
관계기업투자주식처분손실	10,679	10,679	(216,384)	54,516
잡손실	252	132,089	34	66,526
합 계	1,655,209	4,238,258	569,228	2,066,239

21. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기의 금융수익과 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
<b>&lt;금융수익&gt;</b>				
당기손익공정가치측정금융자산 평가이익	-	-	76,608	108,042
외환차익	410,210	2,636,627	524,476	1,703,652
외화환산이익	511,324	810,414	764,572	983,977
이자수익(*1)	405,152	950,231	169,704	325,216
파생상품평가이익	-	32,846	-	-
금융수익 합계	1,326,686	4,430,118	1,535,360	3,120,887

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
<b>&lt;금융원가&gt;</b>				
외환차손	319,601	1,957,932	1,553,126	2,509,612
외화환산손실	438,062	1,578,942	1,793,443	2,184,729
이자비용(*2)	1,900,438	5,009,574	114,699	151,851
금융원가 합계	2,658,101	8,546,448	3,461,268	4,846,192

(\*1) 이자수익에는 실제 발생한 수익 및 현재가치 평가에 따른 금액이 포함되어 있습니다.

(\*2) 이자비용에는 실제 발생한 비용 및 현재가치 평가에 따른 금액, 복구충당금관련 이자비용, 리스부채 관련 발생 비용이 포함되어 있습니다.

## 22. 당기법인세 및 이연법인세

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

### 23. 주당이익

(1) 당분기와 전분기의 기본주당순이익은 다음과 같이 계산되었습니다.

(단위:주, 원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주 당기순이익	(6,388,758,282)	(16,448,151,954)	4,056,250,247	19,014,703,499
가중평균 유통보통주식수	16,498,754	16,498,754	16,303,302	16,402,409
주당순이익	(387)	(997)	249	1,159

(2) 당분기와 전분기의 희석주당순이익은 다음과 같이 계산되었습니다.

(단위:주, 원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주 분기순이익	(2,529,496,104)	(16,448,151,954)	4,056,250,247	19,014,703,499
가중평균 희석유통보통주식수	16,515,723	16,510,976	16,320,980	16,430,927
희석주당순이익	(153)	(996)	249	1,157

### 24. 연결현금흐름표

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름

당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 세부 내역은 다음과 같습니다.

#### ① 조정내역

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
외화환산손실	1,578,942	2,184,729
이자비용	5,105,077	151,851
감가상각비	15,494,751	870,108
무형자산상각비	5,004,804	2,398,187
주식보상비용	722,900	881,885
퇴직급여	1,108,665	1,157,980
장기종업원급여	51,124	-
대손상각비(환입)	217,445	204,665
재고자산평가손실(환입)	(149,549)	2,652,936
파생상품평가손익	(32,846)	-
유형자산처분손익	(1,664,845)	(96,101)
무형자산감액손실	1,016,942	-

무형자산처분손익	(38,300)	-
이자수익	(950,231)	(252,431)
외화환산이익	(810,414)	(983,977)
법인세비용	(1,337,465)	2,189,954
무형자산손상환입	-	(65,650)
사용권자산 처분이익	-	(273)
잡손실	68,593	-
리스부채 재평가이익		(19,845)
현재가치할인차금	-	(72,785)
당기손익-공정가치금융자산의 평가이익	-	(108,042)
관계기업투자주식평가이익	(227,903)	(686,080)
관계기업투자주식평가손실	2,996,622	1,858,825
관계기업투자주식처분이익	-	(1,200,002)
관계기업투자주식처분손실	10,679	54,516
하자보수비	2,595	2,353,040
합 계	28,167,586	13,473,490

② 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	7,614,836	(406,596)
미수금의 감소(증가)	347,767	(605,320)
선급금의 감소(증가)	(487,814)	1,590,951
선급비용의 감소(증가)	244,037	(1,001,946)
선납세금의 감소(증가)	(1,534,348)	-
재고자산의 감소(증가)	23,872,364	(29,502,360)
매입채무의 증가(감소)	(14,151,172)	5,043,920
미지급금의 증가(감소)	(2,373,442)	(1,252,598)
미지급비용의 증가(감소)	(3,857,325)	1,436,264
예수금의 증가(감소)	(308,004)	170,985
선수금의 증가(감소)	41,077	16,894
퇴직급여의 증가(감소)	(1,041,429)	(103,574)
장기종업원급여의 증가(감소)	(16,000)	-
품질보증부채의 증가(감소)	(14,311)	(67,377)
사외적립자산의 감소(증가)	1,021,792	-
미지급법인세의 증가(감소)	-	(2,985)
국고보조금의 취득	177,815	-
합 계	9,535,843	(24,683,742)

(2) 중요한 비현금흐름의 내용

당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

적 요	당분기	전분기
사용권자산 및 리스부채	1,704,326	3,670,356
보험수리적손익	-	13,002
법인세효과	-	2,860

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분	기초금액	재무활동 현금흐름	비현금거래						분기말금액
			외화환산	유동성대체	증가	감소	이자비용	환율변동효과	
단기차입금	62,238,339	18,406,820	1,500,841	-	-	(560,000)	-	-	81,586,000
전환사채	4,234,104	-	-	-	-	-	417,833	-	4,651,937
유동성장기차입금	13,451,200	(10,975,419)	-	8,289,156	-	-	-	-	10,764,937
장기차입금	28,845,886	(833,350)	-	(8,289,156)	10,000,000	-	-	-	29,723,380
유동성리스부채	968,281	(1,219,735)	17,843	448,380	807,879	(64,990)	67,590	5,190	1,030,438
비유동리스부채	865,195	-	2,010	(448,380)	712,872	-	-	7,883	1,139,580
합계	110,603,005	5,378,316	1,520,694	-	11,520,751	(624,990)	485,423	13,073	128,896,272

<전분기>

(단위 : 천원)

구분	기초금액	재무활동 현금흐름	비현금거래					분기말금액	
			외화환산	유동성대체	증가	감소	이자비용		
단기차입금	-	12,817,000	1,531,000	-	-	-	-	-	14,348,000
유동성리스부채	296,044	(806,395)	(10,434)	140,669	874,757	(33,070)	54,153	-	515,724
비유동리스부채	75,073	-	(18,600)	(140,669)	732,268	(19,480)	-	-	628,592
합계	371,117	12,010,605	1,501,966	-	1,607,025	(52,550)	54,153	-	15,492,316



## 25. 특수관계자와의 거래

### (1) 특수관계자 현황

1) 당분기와 전기에 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권, 채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비 고
관계기업과 공동기업	화인칩스(주)	화인칩스(주)	지분법적용대상
	(주)오토실리콘	(주)오토실리콘	지분법적용대상
	(주)다빈칩스	(주)다빈칩스	지분법적용대상
	(주)스카이칩스	(주)스카이칩스	지분법적용대상
기타특수관계자	(주)그린칩스홀딩스	(주)그린칩스홀딩스	특수관계자 개인이 지배하는기업
	(주)그린칩스	(주)그린칩스	특수관계자 개인이 지배하는 기업
	(주)코텍세미컴	(주)코텍세미컴	그린칩스홀딩스의 종속기업
	(주)라운크리에이트	(주)라운크리에이트	그린칩스홀딩스의 종속기업
	(주)코텍플러스	(주)코텍플러스	특수관계자 개인이 지배하는 기업
	노매드투어	노매드투어	그린칩스홀딩스의 종속기업
	노매드 재팬	노매드 재팬	노매드투어의 종속기업
	티더블유메디칼	티더블유메디칼	원팩의 관계기업

### (2) 주요 경영진에 대한 보상

연결회사는 기업 활동의 계획·운영·통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	2,703,221	3,176,516
퇴직급여	354,446	319,676
주식기준보상	565,115	1,191,757
합 계	3,622,782	4,687,949

### (3) 기타특수관계자 주요거래 및 잔액

당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

특수관계자명	제품/상품 매출	기타 매입
화인칩스(주)	57,183	3,627,827
(주)그린칩스	11,316,905	-
노매드투어	-	30,000

(주)스카이칩스	-	164,835
합 계	11,374,088	3,822,662

<전분기>

(단위 : 천원)

특수관계자명	상제품 매출	기타 매입
화인칩스(주)	778,861	4,340,522
(주)그린칩스	28,539,058	-
관악아날로그(주)	-	15,000
노매드투어	-	20,218
(주)원팩	-	1,527,534
합 계	29,317,919	5,903,274

(4) 자금거래

<당분기>

(단위 : 천원)

구분	회사명	자금대여거래		현금출자	배당금 지급
		대여	회수		
기타특수관계자	주주, 임원, 종업원	1,466	(31,110)	-	722,571
기타특수관계자	(주)그린칩스홀딩스	-	-	-	88,930
관계기업	(주)오토실리콘	-	-	2,001,000	-

<전분기>

(단위 : 천원)

구분	회사명	자금대여거래		배당금 지급
		대여	회수	
기타특수관계자	주주, 임원, 종업원	15,000	(25,000)	862,127
기타특수관계자	(주)그린칩스홀딩스	-	-	106,716

(5) 특수관계자에 대한 채권채무의 내용

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분	회사명	채권		채무	
		매출채권	기타	매입채무	기타
관계기업	화인칩스(주)	-	-	789,989	-
기타특수관계자	(주)라운크리에이트	-	24,006	-	-
	(주)그린칩스	1,668,171	-	-	1,021
합 계		1,668,171	24,006	789,989	1,021

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	회사명	채권		채무	
		매출채권	기타	매입채무	기타
관계기업	화인칩스(주)	103,164	-	1,162,741	-
	(주)원팩	-	464,835	-	420,000
기타특수관계자	(주)그린칩스	6,271,265	-	-	6,967
	(주)라온크리에이트	-	85,007	-	420,000
	종업원 대여금	-	56,468	-	-
합 계		6,374,429	606,310	1,162,741	846,967

## 26. 기타약정사항

연결회사는 중소기업청 등으로부터 국책과제 등과 관련하여 당분기 및 전분기 중 국고보조금의 수령 및 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	-	2,546
당기수령액	732,793	1,012,899
당기사용액	(732,793)	(1,015,445)
기말	-	-
장기미지급금(*)	477,629	569,620

(\*) 국고보조금 수령 시 약정사항의 성공여부에 따라 기술료 등의 명목으로 지출될 금액으로 차기 이후에 지출될 금액의 합계액입니다.

## 4. 재무제표

### 4-1. 재무상태표

#### 재무상태표

제 18 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 17 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기말	제 17 기말
자산		
유동자산	102,246,642,125	99,572,141,152
현금 및 현금성자산	36,077,432,286	15,866,024,139
매출채권	22,575,157,029	23,854,682,081
기타채권	4,096,805,473	4,257,293,452
재고자산	35,922,254,991	51,499,369,249
기타유동자산	3,574,992,346	4,094,772,231
비유동자산	84,642,389,484	83,105,671,428
당기손익공정가치금융자산	2,203,823,306	2,163,823,306
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002,210	1,200,002,210
기타비유동금융자산	1,657,102,733	2,554,763,966
종속기업 및 관계기업 투자	53,928,196,652	51,912,606,602
유형자산	3,988,365,444	4,291,763,833
무형자산	9,131,248,216	8,243,381,617
사용권자산	1,672,864,465	1,039,871,676
순확정급여자산		101,918,204
이연법인세자산	10,556,010,707	10,707,919,446

기타비유동자산	304,775,751	889,620,568
자산총계	186,889,031,609	182,677,812,580
부채		
유동부채	54,048,369,535	54,975,631,091
매입채무	6,413,787,022	4,689,418,300
기타채무	3,112,140,414	6,696,420,342
단기차입금	43,896,000,000	39,488,339,073
유동 리스부채	550,518,572	248,460,274
당기법인세부채	(763,702,402)	3,043,986,850
기타 유동부채	839,625,929	809,006,252
비유동부채	2,806,278,893	1,452,018,688
비유동 리스부채	721,532,604	449,273,940
기타비유동금융부채	477,629,006	455,599,508
순확정급여채무	987,608,898	0
기타 비유동 부채	619,508,385	547,145,240
부채총계	56,854,648,428	56,427,649,779
자본		
자본금	8,890,376,500	8,890,376,500
자본잉여금	26,421,998,151	26,421,998,151
기타자본항목	(6,682,133,986)	(7,405,033,999)
기타포괄손익누계액	(430,022,155)	(430,022,155)
이익잉여금(결손금)	101,834,164,671	98,772,844,304
자본총계	130,034,383,181	126,250,162,801
자본과부채총계	186,889,031,609	182,677,812,580

#### 4-2. 포괄손익계산서

##### 포괄손익계산서

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기		제 17 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	32,143,042,155	102,933,270,238	45,570,287,368	164,791,308,162
제품매출액	32,095,404,677	102,753,008,528	45,521,529,440	164,591,902,980
상품매출액	47,637,478	180,261,710	48,757,928	199,405,182
매출원가	27,117,654,958	83,919,551,316	35,692,134,609	120,214,098,675
제품매출원가	27,071,515,360	83,749,180,190	35,670,485,091	120,025,979,376
상품매출원가	46,139,598	170,371,126	21,649,518	188,119,299
매출총이익	5,025,387,197	19,013,718,922	9,878,152,759	44,577,209,487
판매비와관리비	2,635,951,385	9,476,090,506	3,834,794,828	20,212,402,958

영업이익(손실)	2,389,435,812	9,537,628,416	6,043,357,931	24,364,806,529
금융수익	1,186,977,446	3,636,838,484	1,830,721,685	3,119,778,794
금융비용	1,402,947,605	4,894,417,969	3,320,848,757	4,587,669,157
기타수익	1,493,576	73,593,030	1,235,886,976	1,467,112,184
기타비용	1,170,138,184	1,293,629,567	46,788,388	426,447,943
법인세비용차감전순이익(손실)	1,004,821,045	7,060,012,394	5,742,329,447	23,937,580,407
법인세비용(수익)	99,477,283	698,941,227	452,620,962	2,106,507,076
당기순이익(손실)	905,343,762	6,361,071,167	5,289,708,485	21,831,073,331
기타포괄손익			413,213,243	(848,821,238)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			413,213,243	(848,821,238)
순확정급여부채의 재측정요소			413,213,243	(10,141,492)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익				(838,679,746)
총포괄손익	905,343,762	6,361,071,167	5,702,921,728	20,982,252,093
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	386	324	1,331
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	385	324	1,329

### 4-3. 자본변동표

#### 자본변동표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	8,729,826,500	23,084,044,791	(4,468,173,539)	446,166,025	83,208,363,541	111,000,227,318
당기순이익(손실)					21,831,073,331	21,831,073,331
유상증자	160,550,000	3,337,953,360				3,498,503,360
금융자산의 재분류 효과				(838,679,746)	1,075,230,443	236,550,697
주식보상비용재산정					(309,871,493)	(309,871,493)
순확정급여부채의 재측정요소					(10,141,492)	(10,141,492)
배당금의 지급					(3,972,195,840)	(3,972,195,840)
자기주식의(취득)처분			(4,993,987,200)			(4,993,987,200)
주식매입선택권			1,191,756,768			1,191,756,768
2022.09.30 (기말자본)	8,890,376,500	26,421,998,151	(8,270,403,971)	(392,513,721)	101,822,458,490	128,471,915,449
2023.01.01 (기초자본)	8,890,376,500	26,421,998,151	(7,405,033,999)	(430,022,155)	98,772,844,304	126,250,162,801
당기순이익(손실)					6,361,071,167	6,361,071,167
유상증자						
금융자산의 재분류 효과						
주식보상비용재산정						
순확정급여부채의 재측정요소						
배당금의 지급					(3,299,750,800)	(3,299,750,800)
자기주식의(취득)처분						
주식매입선택권			722,900,013			722,900,013
2023.09.30 (기말자본)	8,890,376,500	26,421,998,151	(6,682,133,986)	(430,022,155)	101,834,164,671	130,034,383,181

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기	제 17 기 3분기
영업활동현금흐름	25,850,395,005	5,496,299,233
당기순이익(손실)	6,361,071,167	21,831,073,331
조정	7,356,624,047	11,755,301,997
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	15,708,456,616	(25,636,300,703)
이자수취	707,471,754	259,435,341
이자지급(영업)	(1,441,663,599)	(95,328,863)
법인세환급(납부)	(2,841,564,980)	(2,617,881,870)
투자활동현금흐름	(5,208,489,404)	(2,812,120,889)
장단기금융상품의 처분		4,000,000,000
장단기금융상품의 취득		(2,000,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산 취득	(40,000,000)	
당기손익공정가치측정금융자산 처분		895,691,883
보증금의 감소	719,848,793	392,922,310
보증금의 증가	(717,000,000)	(1,702,398,200)
유형자산의 취득	(333,360,040)	(2,787,760,504)
유형자산의 처분	21,454,544	169,636,362
무형자산의 취득	(3,587,830,537)	(2,138,388,287)
무형자산의 처분	636,363,636	
국고보조금의 취득	61,923,767	178,562,635
국고보조금의 감소		(18,324,376)
대여금의 감소	31,110,433	24,999,993
대여금의 증가		(15,000,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득		(891,704,915)
관계법인 투자주식의 취득	(2,001,000,000)	(120,360,000)
관계법인 투자주식의 처분		1,200,002,210
재무활동현금흐름	(866,698,885)	6,711,836,579
단기차입금의 차입	2,906,819,856	24,241,600,000
단기차입금의 상환		(11,424,600,000)
자기주식의 취득		(4,993,987,200)
리스부채의 감소	473,767,941	637,483,741
배당금의 지급	(3,299,750,800)	(3,972,195,840)
유상증자		3,498,503,360

현금및현금성자산의 증감	19,775,206,716	9,396,014,923
기초현금및현금성자산	15,866,024,139	5,759,130,745
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	436,201,431	17,847,548
기말현금및현금성자산	36,077,432,286	15,172,993,216

## 5. 재무제표 주석

제 18(당)기 분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

제 17(전)기 분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

어보브반도체 주식회사

### 1. 일반사항

어보브반도체 주식회사(이하 "회사")는 비메모리반도체(MCU)를 개발하여 제조 및 판매하는 사업 등을 영위할 목적으로 2006년 1월 11일 설립되었으며, 본점의 소재지는 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93입니다.

회사는 2009년 6월 5일 주식을 KOSDAQ 시장에 상장하였으며, 수차의 증자를 거쳐당분기 말 현재 납입자본금은 8,890백만원입니다.

당분기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)
최원	3,315,643	18.65%
(주)그린칩스홀딩스	444,648	2.50%
자기주식	1,281,999	7.21%
기타	12,738,463	71.64%
합계	17,780,753	100.00%



## 2.1 분기재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 종속기업 및 관계기업투자자산에 대해서 원가법을 적용하고 있습니다.

### 2.1.1 회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

#### (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

동 개정사항은 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가 손익 공시

동 개정사항은 자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

동 개정사항은 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

동 개정사항은 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

## 2.2 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

### 2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

## 3. 중요한 회계추정 및 가정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영자는 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영자가 내린 중요한 판단은 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

## 4. 금융위험관리

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 요약분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

## 5. 현금 및 현금성자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 현금 및 현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	360	-
보통예금	20,707,815	15,661,942
외화예금	15,369,257	204,082
합 계	36,077,432	15,866,024

## 6. 금융상품

### (1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	36,077,432	(*2)	15,866,024	(*2)
매출채권	22,575,157	(*2)	23,854,682	(*2)
기타채권(*1)	3,051,970	(*2)	2,165,996	(*2)
당기손익공정가치금융자산(비유동)	2,203,823	2,203,823	2,163,823	2,163,823
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002
기타비유동금융자산	1,657,103	(*2)	2,554,764	(*2)
금융부채				
매입채무	6,413,787	(*2)	4,689,418	(*2)
기타지급채무(*2)	1,476,975	(*2)	3,394,133	(*2)
단기차입금	43,896,000	(*2)	39,488,339	(*2)
기타비유동금융부채	477,629	(*2)	455,600	(*2)
리스부채				
리스부채(유동)	550,519	(*2)	248,460	(*2)
리스부채(비유동)	721,533	(*2)	449,274	(*2)

(\*1) 금융상품에 해당하지 않는 종업원, 제세금은 제외하였습니다.

(\*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.

(2) 공정가치 서열체계

회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
수준 3	직·간접적으로 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정된 공정가치

당분기말 및 전기말 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	1,200,002	1,200,002
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	-	-	2,203,823	2,203,823

<전기말>

(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	1,200,002	1,200,002
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	-	-	2,163,823	2,163,823

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있으며, 출자형태의 집합투자회사는 분기별 투자내역 및 투자 실적의 평가가 반영된 보고서를 통해 평가하고 있습니다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 당기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

### (3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재의 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함되며, 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측 가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

(4) 당기손익공정가치측정금융자산

당분기말 및 전기말 현재 당기손익공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	종류	주식수	지분율	당분기말		전기말	
				장부가액	공정가액	장부가액	공정가액
메가RS투자조합	조합출자금	835	5.00%	1,166,623	1,166,623	1,166,623	1,166,623
주식회사 씨니웨이브텍	상환전환우선주	38,780	9.07%	997,200	997,200	997,200	997,200
혁신 IP 기술사업화 투자조합(*1)	조합출자금	40	0.33%	40,000	40,000	-	-
합계				2,203,823	2,203,823	2,163,823	2,163,823

(\*1) 당기 6월 혁신 IP 기술사업화 투자조합에 출자를 결정하였으며, 출자금 40백만원 출자하여, 투자조합에 대한 0.33%의 지분율을 획득하였습니다.

(5) 기타포괄손익공정가치측정금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주, %)

회사명	종류	주식수	지분율	당분기말		전기말	
				장부가액	공정가액	장부가액	공정가액
관악아날로그(주)	보통주	55,550	7.14%	1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002
합계				1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002



7. 매출채권, 기타채권 및 기타금융자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 매출채권, 기타채권 및 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
유동			
매출채권	매출채권	22,575,229	23,855,639
	대손충당금	(72)	(956)
	합 계	22,575,157	23,854,683
기타채권	미수금	1,376,805	2,341,193
	대손충당금	-	-
	유동성임차보증금	2,720,000	1,916,100
	합 계	4,096,805	4,257,293
비유동			
기타금융자산	보증금	1,891,649	2,622,998
	현재가치할인차금	(234,546)	(99,345)
	장기대여금	-	31,110
	합 계	1,657,103	2,554,763

손상된 매출채권에 대한 대손충당금 설정액은 포괄손익계산서상 '대손상각비'에 포함되어 있으며, 기타상각후원가측정금융자산에 대한 대손충당금 설정액은 '기타의 대손상각비'에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 해당 채권과 대손충당금은 제각하고 있습니다.

기타비유동금융자산의 구성내역으로는 리스와 관련한 임차보증금과 임직원대여금으로 구성되어 있으며, 각각 임차자산과 임금채권을 담보하고 있어 기대신용손실의 발생 가능성은 매우 낮습니다.

8. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실 총당금	장부금액	취득원가	평가손실 총당금	장부금액
상품	-	-	-	2,463	(2,463)	-
제품	7,264,458	(744,712)	6,519,746	14,109,634	(1,059,414)	13,050,220
원재료	7,252,026	(331,222)	6,920,804	16,306,049	(542,153)	15,763,896
재공품	23,806,455	(1,324,750)	22,481,705	24,248,782	(1,563,529)	22,685,253
합 계	38,322,939	(2,400,684)	35,922,255	54,666,928	(3,167,559)	51,499,369

(2) 당분기와 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실 및 환입은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가		
재고자산평가손실	-	2,652,936
재고자산평가손실 환입	764,411	-

9. 종속기업 및 관계기업투자주식

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
종속기업	44,752,284	44,594,499
관계기업 및 공동기업 (*)	9,175,913	7,318,108
합계	53,928,197	51,912,607

(\*) 당사는 당기 중 (주)오토실리콘에 2,001백만원을 추가 출자하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	51,912,607	45,301,145
취득	2,158,785	478,998
처분	(143,195)	(1,473,551)
분기말 장부금액	53,928,197	44,306,592

10. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	4,291,764	2,193,381
일반취득 및 자본적지출	287,320	2,772,101
감가상각	(568,261)	(438,057)
처분·폐기·손상	(22,458)	(73,535)
기타	-	(27,101)
분기말 장부금액	3,988,365	4,426,789

(\*) 취득과 관련하여 수취한 국고보조금을 차감한 순액으로 표시하였습니다.

(2) 당분기와 전분기의 유형자산 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가	438,491	312,156
판매비와 관리비	132,983	125,901
합계	571,474	438,057

(3) 사용권자산 및 리스부채

① 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	1,039,872	368,898
일반취득 및 자본적지출	1,230,356	1,365,163
감가상각	(597,364)	(407,247)
처분·폐기·손상	-	(54,391)
분기말 장부금액	1,672,864	1,272,423

② 당분기 및 전분기 중 사용권자산 관련 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부가액	697,734	317,367
증가	1,048,085	1,165,535
감소	-	(52,550)
지급	(512,458)	(637,484)
이자비용	38,690	41,373
분기말 장부금액	1,272,051	834,241

③ 당분기와 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비(매출원가)	318,177	256,048
사용권자산 감가상각비(판매비와 관리비)	275,972	151,199
리스부채 이자비용	38,690	41,373

## 11. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초장부금액	8,243,382	8,892,226
취득	4,158,548	2,127,842
감가상각	(1,655,676)	(2,239,665)
처분·폐기·손상	(1,615,006)	83,974
분기말 장부금액	9,131,248	8,864,377

(2) 당분기와 전분기의 무형자산상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가	1,573,443	2,149,222
판매비와 관리비	82,134	90,443
합 계	1,655,577	2,239,665

12. 매입채무 및 기타채무와 기타비유동금융부채

당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무와 기타비유동금융부채 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	
	유동	비유동	유동	비유동
매입채무	6,413,787	-	4,689,419	-
미지급금	1,421,973	477,629	2,414,489	455,600
미지급비용	1,690,167	-	4,281,931	-
합 계	9,525,927	477,629	11,385,839	455,600

13. 순확정급여부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에 인식하는 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
확정급여채무 현재가치	8,986,211	8,586,859
사외적립자산 공정가치	(7,998,602)	(8,688,777)
순확정급여부채(자산)	987,609	(101,918)



(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
당기근무원가	1,073,043	954,881
순이자원가 등	(56,060)	(13,046)
합 계(*)	1,016,983	941,835

(\*)포괄손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출원가	701,849	843,203
판매비와 관리비	315,134	98,572
합 계	1,016,983	941,775

(3) 당분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 91,683 천원 (전분기: 216,145 천원) 입니다.

## 14. 차입금

### (1) 단기차입금

당기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금융기관명	내역	이자율(%)	만기연월	당분기말	전기말
단기차입금	한국수출입은행	운영자금	5.50%	2024.04	13,448,000	12,673,000
	한국수출입은행	운영자금	5.10%	2023.10	4,034,400	3,801,900
	KDB산업은행	운영자금	6.73%	2023.11	5,177,362	4,878,994
	KDB산업은행	운영자금	6.56%	2023.11	1,203,821	1,134,445
	KDB산업은행	운영자금	4.49%	2023.11	7,000,000	7,000,000
	KDB산업은행	운영자금	4.81%	2023.12	10,000,000	10,000,000
	KDB산업은행	운영자금	6.68%	2023.11	696,679	-
	KDB산업은행	운영자금	6.71%	2023.11	1,226,930	-
	KDB산업은행	운영자금	6.56%	2023.11	1,108,808	-
합 계					43,896,000	39,488,339

### (2) 제공받은 지급보증

당분기말 현재 회사가 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

기관명	보증금액	보증내용
서울보증보험	72,100	채권 가압류 담보(*)

(\*) 회사는 매출채권 가압류를 위해 공탁보증보험을 가입했습니다.

15. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 회사의 수권주식수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 500원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주 자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)

구분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수	17,780,753	17,780,753
보통주 자본금	8,890,377	8,890,377
주식발행초과금	26,421,998	26,421,998
기타자본		
자기주식	(10,587,739)	(10,587,739)
자기주식처분이익	705,847	705,847
주식선택권	3,199,758	2,476,858
합 계	(6,682,134)	(7,405,034)
자기주식 수	1,281,999	1,281,999

(2) 당분기말 전기말 현재 회사의 유통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구분	당분기말			전기말		
	발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수
발행주식수	17,780,753	(1,281,999)	16,498,754	17,780,753	(1,281,999)	16,498,754

## 16. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
<당기손익으로 재분류되지 않는 항목>		
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(430,022)	(430,022)
합계	(430,022)	(430,022)

## 17. 이익잉여금

(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
법정적립금	2,209,101	1,879,126
보험수리적손익	(373,868)	(373,868)
미처분이익잉여금(*1)	99,998,932	97,267,586
합계	101,834,165	98,772,844

(\*1) 당기 중 22년도 연차배당금 3,299,751 천원이 전액 지급되었습니다.

### (2) 법정적립금

회사의 법정적립금은 이익준비금으로 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산 기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용이 가능합니다.

18. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익과 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출	32,095,405	102,753,009	45,521,529	164,591,903
상품매출	47,637	180,262	48,758	199,405
합계	32,143,042	102,933,271	45,570,287	164,791,308

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

< 당분기 >

(단위: 천원)

수익인식 시점	국내	중국	기타	계
한 시점에 인식	71,812,355	29,014,670	2,106,246	102,933,271

< 전분기 >

(단위: 천원)

수익인식 시점	국내	중국	기타	계
한 시점에 인식	116,086,751	45,420,706	3,283,851	164,791,308

(3) 당분기와 전분기 중 고객으로부터의 매출액이 회사 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
고객A	11,271,834	34,340,525	15,996,554	50,118,372
고객B	1,907,820	11,316,905	7,511,161	28,539,058
고객C	8,848,265	22,917,617	8,012,100	37,624,709
고객D	1,059,394	8,556,933	2,411,478	14,191,175

19. 판매비와 관리비

당분기와 전분기 중 판매비와 관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	1,255,244	4,376,381	1,553,339	4,640,146
상여금	36,013	386,310	803,527	2,884,790
퇴직급여	120,509	356,614	217,705	314,718
복리후생비	182,538	537,626	115,495	705,421
여비교통비	36,831	180,141	62,304	168,904
감가상각비	143,452	408,955	116,252	277,101
세금과공과금	46,935	273,361	90,254	256,237
운반비	107,465	350,745	163,544	533,333
지급수수료	312,120	1,361,377	194,536	6,428,666
기타	394,844	1,244,581	517,839	4,003,087
합 계	2,635,951	9,476,091	3,834,795	20,212,403

20. 기타수익과 기타비용

(1) 당분기와 전분기 중 회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
잡이익	1,494	33,371	34,248	46,471
무형자산손상차손환입	-	-	-	103,620
무형자산처분이익	-	38,300	-	-
유형자산처분이익	-	1,922	1,636	117,018
관계기업투자주식처분이익	-	-	1,200,002	1,200,002
합 계	1,494	73,593	1,235,886	1,467,111

(2) 당분기와 전분기 중 회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
기부금	10,000	79,000	14,284	27,485
무형자산감액손실	1,016,942	1,016,942	32,470	37,970
지분법적용투자주식처분손실	143,195	143,195	-	273,549
유형자산처분손실	-	2,926	-	20,917
잡손실	1	51,567	34	66,526
합 계	1,170,138	1,293,630	46,788	426,447



21. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기의 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
<금융수익>				
당기손익공정가치측정금융자산 평가이익	-	-	76,608	108,043
이자수익(*1)	341,305	810,225	169,327	324,108
외환차익	123,155	2,037,363	820,215	1,703,652
외화환산이익	722,517	789,250	764,572	983,976
금융수익 합계	1,186,977	3,636,838	1,830,722	3,119,779

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
<금융비용>				
이자비용(*2)	610,752	1,623,720	110,578	139,071
외환차손	241,638	1,588,329	1,434,776	2,391,263
외화환산손실	609,870	1,524,202	1,775,495	2,057,335
금융보증비용	(59,312)	158,167	-	-
금융비용 합계	1,402,948	4,894,418	3,320,849	4,587,669

(\*1) 이자수익에는 실제 발생된 수익 및 현재가치 평가에 따른 금액이 포함되어 있습니다.

(\*2) 이자비용에는 실제 발생된 비용 및 현재가치 평가에 따른 금액, 복구충당금관련이자비용, 리스부채 관련 발생 비용이 포함되어 있습니다.

## 22. 법인세비용 및 이연법인세

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 9.90%입니다.

## 23. 현금흐름표

### (1) 영업활동에서 창출된 현금흐름

당분기와 전분기 중 영업활동에서 창출된 현금흐름의 세부 내역은 다음과 같습니다

#### ① 조정내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
외화환산손실	1,524,203	2,057,335
이자비용	1,623,720	139,072
감가상각비	1,165,623	845,304
무형자산상각비	1,655,577	2,239,665
주식보상비용	565,115	523,248
퇴직급여	1,108,665	1,157,980
장기종업원급여	51,124	-
대손상각비 환입(설정)	(885)	204,665
재고자산평가손실 환입	(764,411)	2,652,936
무형자산감액손실	1,016,942	-
이자수익	(810,226)	(251,323)
외화환산이익	(789,250)	(983,977)
법인세비용	698,941	2,106,507
유형자산처분손익	1,003	(96,101)
무형자산처분손익	(38,300)	-
무형자산손상환입	-	(65,650)
잡손실	44,825	(273)
리스부채 재평가이익	-	(19,845)
당기손익-공정가치금융자산평가이익	-	(108,042)
관계기업투자주식처분손실	143,195	273,549
관계기업투자주식처분이익	-	(1,200,002)
현재가치할인차금	-	(72,785)
하자보수비	2,596	2,353,039
금융보증비용	158,167	-
합 계	7,356,624	11,755,302

② 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	1,630,217	(2,710,541)
미수금의 감소	965,662	(605,320)
선급금의 감소	(2,087)	1,600,317
선급비용의 감소(증가)	342,394	(963,345)
재고자산의 감소(증가)	16,341,525	(26,525,370)
매입채무의 증가(감소)	1,702,975	3,313,334
미지급금의 증가(감소)	(970,487)	(1,252,598)
미지급비용의 증가(감소)	(2,773,558)	1,409,805
예수금의 증가(감소)	(184,470)	170,985
선수금의 증가(감소)	41,077	16,894
퇴직급여의 증가(감소)	(1,040,931)	(103,546)
품질보증부채의 증가(감소)	(14,311)	(67,377)
사외적립자산의 감소(증가)	1,021,793	-
미지급법인세의 증가(감소)	-	80,461
국고보조금의 취득	177,815	-
기타	(1,529,157)	-
합 계	15,708,457	(25,636,301)

(2) 중요한 비현금흐름의 내용

당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

적	요	당분기	전분기
사용권자산		1,230,356	3,248,711
보험수리적손익		-	13,002
법인세효과		-	2,860

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분	기초금액	재무활동 현금흐름	비현금거래					기말금액
			외화환산	유동성대체	증가	감소	이자비용	
단기차입금	39,488,339	2,906,820	1,500,841	-	-	-	-	43,896,000
유동성리스부채	248,460	(512,458)	-	225,363	550,463	-	38,690	550,518
비유동리스부채	449,274	-	-	(225,363)	497,621	-	-	721,532
합계	40,186,073	2,394,362	1,500,841	-	1,048,084	-	38,690	45,168,050

<전분기>

(단위 : 천원)

구분	기초금액	재무활동 현금흐름	비현금거래					기말금액
			외화환산	유동성대체	증가	감소	이자비용	
단기차입금	21,760,000	-	-	-	-	(21,760,000)	-	-
유동성리스부채	556,157	-	-	(210,053)	-	-	-	346,104
비유동리스부채	206,633	(456,901)	-	210,053	93,543	-	10,424	63,752
합계	22,522,790	(456,901)	-	-	93,543	(21,760,000)	10,424	409,856

## 24. 특수관계자와의 거래

### (1) 특수관계자 현황

1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)		소재지
	당분기말	전기말	
ABOV SEMICONDUCTOR (HK) CO LTD	100.00%	100.00%	홍콩
ABOV SEMICONDUCTOR VINA COMPANY LIMITED	100.00%	100.00%	베트남
(주)원팩	38.31%	38.31%	한국

2) 당분기와 전기에 현재 당사와 매출 등 거래 또는 채권,채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비 고
관계기업	화인칩스(주)	화인칩스(주)	지분법적용대상
	(주)오토실리콘	(주)오토실리콘	지분법적용대상
	(주)다빈칩스	(주)다빈칩스	지분법적용대상
	(주)스카이칩스	(주)스카이칩스	지분법적용대상
기타특수관계자	(주)그린칩스홀딩스	(주)그린칩스홀딩스	특수관계자 개인이 지배하는기업
	(주)그린칩스	(주)그린칩스	특수관계자 개인이 지배하는 기업
	(주)코텍세미컴	(주)코텍세미컴	그린칩스홀딩스의 종속기업
	(주)라운크리에이트	(주)라운크리에이트	그린칩스홀딩스의 종속기업
	(주)코텍플러스	(주)코텍플러스	특수관계자 개인이 지배하는 기업
	노매드투어	노매드투어	그린칩스홀딩스의 종속기업
	노매드 재팬	노매드 재팬	노매드투어의 종속기업
	티더블유메디칼	티더블유메디칼	원팩의 관계기업

(2) 주요 경영진에 대한 보상

회사는 기업 활동의 계획·운영·통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	2,634,422	3,079,311
퇴직급여	354,446	319,676
주식기준보상	565,115	1,191,757
합 계	3,553,983	4,590,744

(3) 기타특수관계자 주요거래 및 잔액

당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출	매입
	제품/상품매출	기타
ABOV H.K.	22,917,617	-
ABOV VINA	-	509,814
화인칩스(주)	57,183	3,627,827
(주)그린칩스	11,316,905	-
노매드투어	-	30,000
(주)스카이칩스	-	164,835
(주)원팩	-	1,707,530
합 계	34,291,705	6,040,006

<전분기>

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출	매입
	제품/상품매출	기타
ABOV H.K.	37,624,709	-
화인칩스(주)	778,861	4,340,522
(주)그린칩스	28,539,058	-
관악아날로그테크놀러지(주)	-	15,000
노매드투어	-	20,218
(주)원팩	-	1,527,535
합 계	66,942,628	5,903,275

(4) 자금거래

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분	회사명	자금대여거래		현금출자	배당금지급
		대여	회수		
관계기업	(주)오토실리콘	-	-	2,001,000	-
기타특수관계자	주주, 임원, 종업원	-	(31,110)	-	722,571
	(주)그린칩스홀딩스	-	-	-	88,930

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	회사명	자금대여거래		현금출자	배당금지급
		대여	회수		
종속기업	ABOV SEMICONDUCTOR VINA COMPANY LIMITED	-	-	120,360	-
	(주)원팩	-	-	11,999,999	-
관계기업	(주)스카이칩스	-	-	891,705	-
기타특수관계자	주주, 임원, 종업원	15,000	(33,333)	-	862,127
	(주)그린칩스홀딩스	-	-	-	106,716

(5) 특수관계자에 대한 채권채무의 내역

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분	회사명	채권		채무	
		매출채권	기타	매입채무	기타
종속기업	ABOV H.K	10,083,753	7,972	-	-
	주식회사 윈팩	-	-	200,330	-
관계기업	화인칩스(주)	-	-	789,989	-
기타특수관계자	(주)그린칩스	1,668,171	-	-	1,021
	(주)라운크리에이트	-	24,006	-	-
합 계		11,751,924	31,978	990,319	1,021

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	회사명	채권		채무	
		매출채권	기타	매입채무	기타
종속기업	ABOV H.K	8,215,002	7,513	-	-
	주식회사 윈팩	-	-	59,669	-
관계기업	화인칩스(주)	103,164	-	1,162,740	-
	주식회사 스카이칩스	-	464,835	-	420,000
기타특수관계자	(주)그린칩스	6,271,265	-	-	6,967
	(주)라운크리에이트	-	85,007	-	-
	종업원 대여금	-	31,110	-	-
합 계		14,589,431	588,465	1,222,409	426,967

(6) 당분기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

특수관계자구분	제공받은회사	여신금융기관	여신금액	보증금액	비고
종속기업	(주)윈팩	한국수출입은행	2,500,000	3,000,000	금융기관 차입보증

(\*) 당사는 23년 5월 (주) 윈팩에 대한 금융보증을 실시 하였으며 당분기말 상기 지급보증과 관련하여 금융보증부채로 217,479 천원을 계상하고 있습니다.

<전기말>

(단위 : 천원)

특수관계자구분	제공받은회사	여신금융기관	여신금액	보증금액	비고
-	-	-	-	-	-



## 25. 우발채무와 기타약정사항

(1) 회사는 중소기업청 등으로부터 국책과제 등과 관련하여 당분기 및 전기 중 국고보조금의 수령 및 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
기초	-	2,546
당기수령액	732,793	1,322,480
당기사용액	(732,793)	(1,325,026)
장기미지급금(*1)	477,629	455,600

(\*1) 국고보조금 수령 시 약정사항의 성공여부에 따라 기술료 등의 명목으로 지출될 금액으로 차기이후에 지출될 금액의 합계액입니다.

(2) 당분기말 현재 회사가 타인에게 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받는자	보증내역	보증금액	비 고
(주)원팩	차입금 연대보증	3,000,000	-

## 6. 배당에 관한 사항

### 가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 경쟁사 배당성향, 주주가치 제고, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

정관에 기재된 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

#### 제44조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
- ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
- ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고 하여야 한다.
- ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

#### 제44조의2(분기배당)

- ① 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9 월의 말일(이하 “분기배

당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

- ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
- ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
  - 1. 직전결산기의 자본금의 액
  - 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
  - 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
  - 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준비금
  - 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
  - 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
- ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제8조 2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제45조(배당금지청구권의 소멸시효)

- ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제18기 3분기	제17기	제16기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-6,657	12,447	13,707
(별도)당기순이익(백만원)		6,361	18,804	13,186
(연결)주당순이익(원)		-997	770	828
현금배당금총액(백만원)		-	3,300	3,972
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	26.5	29.0
현금배당수익률(%)	보통주	-	2.30	1.72
	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	240
	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분이익입니다.

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	14	1.8	2.1

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

#### 가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2022년 08월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	321,100	500	10,900	-

#### 나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음

#### 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음

#### 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

### 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
(주)원팩	회사채	사모	2021년 06월 11일	5,000	0.0	-	2024년 06월 11일	-	KB증권
(주)원팩	회사채	사모	2023년 08월 02일	12,000	0.0	-	2028년 08월 02일	-	KB증권
(주)원팩	회사채	사모	2023년 08월 02일	4,000	0.0	-	2028년 08월 02일	-	KB증권
합 계	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-

(\*) 상기 자료는 공시서식에 따라 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.

### 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 상기 자료는 공시서식에 따라 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.

### 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 상기 자료는 공시서식에 따라 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.

### 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	5,000	-	-	-	16,000	-	-	21,000
	합계	5,000	-	-	-	16,000	-	-	21,000

(\*) 상기 자료는 공시서식에 따라 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.

### 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 상기 자료는 공시서식에 따라 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.

### 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 상기 자료는 공시서식에 따라 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

### 가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

구분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
유상증자 (3자배정)	8	2022년 08월 25일	시설자금	3,500	시설투자	979	순차 투자 예정

### 나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
예·적금	CMA	2,521	-	122일
계		2,521	-	

### 다. 공모자금의 사용내역

- 해당사항 없음

## 8. 기타 재무에 관한 사항

### 가. 재무제표 재작성 등 유의사항

- 해당사항 없음

### 나. 대손충당금 설정현황 (연결기준)

#### (1) 대손충당금 설정 방침

개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고, 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다.

또한 약정일이 존재하는 채권의 경우 약정일이 경과한 채권은 연체 채권으로 구분하고 있으며, 약정일 미도래 채권은 정상채권으로 구분하고 있습니다.

연체된 채권에 대해서는 보고 기간 종료 이후의 회수 내역 및 연체에 대한 과거 경험, 약정일을 초과하는 연체 지급 횟수, 당사의 구체적 회수 방안등을 고려하여 개별 채권에 대한 충당금 설정을 하고 있습니다. 정상채권의 경우에는 과거 대손 경험율에 근거하여 연령 분석 후

충당금을 설정하고 있습니다.

매출채권 회수가 불가능하다고 판단되는 경우 손상차손은 충당금 계정에서 제각하고 있습니다. 만약 기존에 제각하였던 금액이 후속적으로 회복된 경우 충당금 계정을 증가시키는 회계처리를 하고 있습니다.

충당금 계정의 장부금액 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(2) 대손충당금 설정 근거

① 대손 경험률 : 과거 채권 잔액에 대한 과거의 실제 대손발생 경험을 근거로 설정하고 있습니다.

② 대손예상액 산정

- 집합평가 : 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 기타 채권에 대하여 대손 경험률을 근거로 산정하고 있습니다. (단, 개별평가 대상은 제외)
- 개별평가 : 채권의 연령분석과 거래처별 결제조건, 미회수 채권에 대한 거래처의 회수 가능성을 개별 판단 후 손상의 객관적 사유 발생시 충당금을 설정하고 있습니다.

③ 대손처리 기준 : 매출채권 및 기타채권에 대하여 아래와 같은 사유 발생시 대손처리 합니다.

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 기타 위에 준하는 회수불가능한 사유가 발생한 경우

(3) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
				설정률
제18기 3분기	매출채권	24,038,456	218,402	0.91%
	미수금	2,538,370	277,786	10.94%
	단기대여금	1,088,824	1,012,000	92.94%
	합 계	27,665,650	1,508,188	5.45%
제17기	매출채권	31,204,416	63,343	0.20%
	미수금	2,884,673	277,786	9.63%
	단기대여금	1,087,358	1,012,000	93.07%
	장기대여금	31,110	-	0.00%
	합 계	35,207,557	1,353,129	3.84%
제16기	매출채권	20,771,109	176,965	0.85%
	미수금	3,486,258	19,428	0.56%
	단기대여금	37,146	-	-
	장기대여금	49,444	-	-
	합 계	24,334,957	196,393	0.81%

	합 계	24,343,957	196,393	0.81%
--	-----	------------	---------	-------

(4) 최근 사업연도의 대손충당금 변동 현황

(단위 : 천원)

구 분	제18기 3분기	제17기	제16기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,353,129	196,393	224,035
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	(952,613)	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	399,559	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	(1,352,172)	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	155,059	204,123	(27,642)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,508,188	1,353,129	196,393

(5) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	14,790,167	2,732	25	0	14,792,924
	특수관계자	11,783,902				11,783,902
	합 계	26,574,069	2,732	25	0	26,576,826
구성비율		99.99%	0.01%	0.00%	0.00%	100.00%

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (연결기준)

(1) 재고자산의 부문별 보유 현황

(단위 : 천원)

구분	계정과목	제18기 3분기	제17기	제16기
비메모리 반도체 MCU 부문	제 품	7,588,392	15,483,744	3,938,881
	원재료	17,393,643	12,616,686	10,206,210
	재공품	12,008,867	25,832,463	2,791,811
	소 계	36,990,902	53,932,893	16,936,902
반도체 후공정 (PKG 및 TEST)부문	원재료	5,514,746	11,337,966	-
	재공품	426,684	1,269,399	-
	소 계	5,941,430	12,607,365	-
합계	제 품	7,588,392	15,483,744	3,938,881
	원재료	22,908,389	23,954,652	10,206,210
	재공품	12,435,551	27,101,862	2,791,811
	합 계	42,932,332	66,540,258	16,936,902

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	13.46%	39.01%	12.64%
[재고자산합계÷기말자산총계×100]			
재고자산회전율(회수)	3.99회	4.46회	7.75회
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]			

※ 당사의 영업활동은 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 재고자산 실사일자 및 방법

당사의 정기 재고실사는 매 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 실시하고 있으며, 분, 반기말에는 자체적인 재고실사를 실시하고 있습니다.

(3) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부등

매 사업연도 종료일 기준 재고실사 시 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다.

(4) 실사방법

- ① 사내보관재고: 원재료의 경우 전수조사를 원칙으로 하며, 일부 중요성이 작은 품목의 경우 Sample 조사를 합니다.
- ② 사외보관재고: 제3자 보관재고에 대해서는 보관처의 '타처보관 확인서'를 통해 확인하며, 운송중인 재고에 대해서는 운송장 등의 서류를 통하여 확인하고 있습니다.

(5) 장기체화 재고 등 현황

재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있으며, 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하고 있습니다.

또한 재고자산의 순실현 가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가 손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	제18기 3분기			
	취득원가	보유금액	평가손실 총당금	당기말 장부금액
제 품	8,333,104	8,333,104	(744,712)	7,588,392
원재료	13,345,812	13,345,812	(910,261)	12,435,551
재공품	24,233,139	24,233,139	(1,324,750)	22,908,389
합 계	45,912,055	45,912,055	(2,979,723)	42,932,332

라. 공정가치 평가방법 및 내역 (연결기준)

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	



	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	50,674,429	(*2)	20,717,624	(*2)
기타유동금융자산	5,159	(*2)	4,877	(*2)
매출채권	23,820,054	(*2)	31,141,072	(*2)
기타채권(*1)	4,474,540	(*2)	2,250,859	(*2)
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	2,203,823	2,203,823	2,163,823	2,163,823
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002
기타비유동금융자산	2,609,480	(*2)	3,025,603	(*2)
금융부채				
매입채무	10,918,427	(*2)	24,530,336	(*2)
기타채무(*2)	2,962,479	(*2)	11,122,909	(*2)
단기차입금	81,586,000	(*2)	62,238,339	(*2)
유동성장기차입금	10,764,937	(*2)	13,451,200	(*2)
유동성전환사채	4,651,938	(*2)	4,311,793	(*2)
장기차입금	29,723,380	(*2)	28,845,886	(*2)
기타비유동금융부채	477,629	(*2)	455,600	(*2)
리스부채				
리스부채(유동)	1,030,438	(*2)	968,281	(*2)
리스부채(비유동)	1,139,579	(*2)	865,195	(*2)

(\*1) 금융상품에 해당하지 않는 종업원,제세금 및 리스 관련 부채는 제외하였습니다.

(\*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.

(2) 공정가치 서열체계

연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
수준 3	직·간접적으로 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정된 공정가치

당분기말 및 전기말 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	1,200,002	1,200,002
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	-	-	2,203,823	2,203,823
파생상품부채	-	-	43,772	43,772

<전기말>

(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	1,200,002	1,200,002
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	-	-	2,163,823	2,163,823
파생상품부채	-	-	76,618	-

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있으며, 출자형태의 집합투자회사는 분기별 투자내역 및 투자 실적의 평가가 반영된 보고서를 통해 평가하고 있습니다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(3) 당기손익공정가치측정금융자산

당분기말 및 전기말 현재 당기손익공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	종류	주식수	지분율	당분기말		전기말	
				장부가액	공정가액	장부가액	공정가액
메가RS투자조합	조합출자금	835	5.00%	1,166,623	1,166,623	1,166,623	1,166,623
주식회사 씨니웨이브텍	상환전환우선주	38,780	9.07%	997,200	997,200	997,200	997,200
혁신 IP 기술사업화 투자조합(*1)	조합출자금	40	0.33%	40,000	40,000	-	-
합계				2,203,823	2,203,823	2,163,823	2,163,823

(\*1) 당기 6월 혁신 IP 기술사업화 투자조합에 출자를 결정하였으며, 출자금 40백만원 출자하여, 투자조합에 대한 0.33%의 지분율을 획득하였습니다.

(4) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주, %)

회사명	종류	주식수	지분율	당분기말		전기말	
				장부가액	공정가액	장부가액	공정가액
관악아날로그㈜	보통주	5,555	7.14%	1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002
합계				1,200,002	1,200,002	1,200,002	1,200,002

마. 진행율적용 수주계약현황

- 해당사항 없음

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.

## V. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

#### 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제18기 (당기)	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	- 해당사항 없음
제17기 (전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	- 종속기업투자주식에 대한 손상평가 - 주식회사 원팩 지분의 단계적 취득에 따른 사업결합 - 영업권을 포함하는 현금창출단위의 손상평가
제16기 (전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 수익인식

#### 나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제18기 (당기)	삼일회계법인	재무제표 감사 (연결 및 별도) 내부회계관리제도 감사 반기 재무제표 검토 (연결 및 별도)	235,000	2,350	117,500	830
제17기 (전기)	삼일회계법인	재무제표 감사 (연결 및 별도) 내부회계관리제도 감사 반기 재무제표 검토 (연결 및 별도)	210,000	2,184	210,000	2,489
제16기 (전전기)	대주회계법인	연결 재무제표/재무제표 감사	85,000	1,010	85,000	1,240

주1) 제18기 감사계약내역의 보수는 연간 총보수 계약액이며, 시간은 계약시점의 총 추정 감사(검토 포함) 시간입니다. 실제수행내역의 보수는 23년 1월~9월말 기간 중 실제 지급된 누적 금액이며 시간은 동일자까지 소요된 누적 시간입니다.

#### 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제18기	-	-	-	-	-
제17기	2022-07-06	법인세 및 지방소득세 세무조정	4개월 (23.01-23.04)	12백만원	-
제16기	-	-	-	-	-

#### 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
----	----	-----	----	----------

1	2023년 02월 20일	회사측: 감사 및 이사회 감사인측: 업무수행 이사, 담당 공인회계사 2인	서면회의	핵심감사사항에 대한 감사계획 등
2	2023년 03월 19일	회사측: 감사 및 이사회 감사인측: 업무수행 이사, 담당 공인회계사 2인	서면회의	기말감사 주요 검토사항, 핵심감사사항에 대한 감사결과, 외부감사인의 독립성 업데이트 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항
3	2023년 08월 11일	회사측: 감사 및 이사회 감사인측: 업무수행 이사, 담당 공인회계사 2인	서면회의	2023년 감사업무 계획 및 전략, 감사인의 독립성 등

## 2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

#### 가. 이사의 구성

당사의 업무집행 의사결정을 위한 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 감사는 상근으로 독립적 자문 역할을 수행하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	직책
사내이사	최원	대표이사 (이사회회장)
	김경호	대표이사
	한대근	고문
사외이사	박성우	사외이사

#### - 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
4	1	-	-	-

#### 나. 주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사			사외이사
			최원 (출석률 100%)	김경호 (출석률 100%)	한대근 (출석률 100%)	박성우 (출석률 100%)
			찬반여부			
2023.02.20	- 제17기 별도 및 연결 내부결산 재무제표 승인 의 건 - 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	이사선임 前	찬성	찬성
2023.03.13	- 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건	가결	찬성		찬성	찬성
2023.04.27	- 외화단기차입금 연장의 건 - 종속법인 채무에 대한 연대보증의 건 - 주식매수선택권 취소 및 부여의 건 - 벤처투자조합 펀드 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.06.23	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2023.09.15	- 해외법인 투자 검토의 건 - 양도제한조건부주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

## 다. 이사회내 위원회

- 해당사항 없음

## 라. 이사의 독립성

### (1) 이사의 선임

당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천 받아 주주총회 의안으로 제출하고, 해당 이사후보자는 주주총회를 통해 선임되고 있습니다.

성명	직명	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계
최원	대표이사 (사내이사)	2021.03- 2024.03(5회)	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	경영총괄	-	본인
김경호	대표이사 (사내이사)	2023.03- 2026.03(0회)	당사 사업 개발 부문 등 사업 운영 총괄 업무를 수행	이사회	사업운영 총괄	-	-
한대근	사내이사	2022.03- 2025.03(1회)	경영 전반 및 대외적 업무를 수행하기 위함	이사회	경영전반	-	-
박성우	사외이사	2022.03- 2025.03(0회)	당사 사업 관련 지원 및 감독 활동을 수행하기 위함	이사회	경영전반	-	-

### (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음

## 마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

### (1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	이사회 안건 사전 자료 제공 및 설명으로 대체

### (2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원팀	8	팀장 등	직무수행을 위한 자료 제공

## 2. 감사제도에 관한 사항



당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상임감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

### 가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력	비고
채재호	1955년 08월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대 전자공학 학사 졸업</li> <li>- (전) LG반도체(주) 사업담당</li> <li>- (전) 하이닉스 반도체 상무</li> <li>- (전) 동부하이텍 전략담당 부사장</li> <li>- (전) 어보브반도체(주) 개발본부 부사장</li> <li>- (현) 어보브반도체(주) 감사</li> </ul>	-

### 나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 서면으로 의견을 진술할 수 있습니다.

당사는 회사의 회계와 업무에 대한 사항을 수시로 보고하고, 회사에 현저하게 손해를미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 보고하며, 감사업무가 효율적으로 수행되도록 경영지원팀에서 지원하고 있습니다.

### 다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	상근감사
			채재호 (출석률: 100%)
			참석여부
2023.02.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제17기 별도 및 연결 내부결산 재무제표 승인의 건</li> <li>- 타법인 주식 취득의 건</li> </ul>	가결	참석
2023.03.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건</li> </ul>	가결	참석
2023.04.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 외화단기차입금 연장의 건</li> <li>- 종속법인 채무에 대한 연대보증의 건</li> <li>- 주식매수선택권 취소 및 부여의 건</li> <li>- 벤처투자조합 펀드 출자의 건</li> </ul>	가결	참석
2023.06.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표이사 선임의 건</li> </ul>	가결	참석
2023.09.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해외법인 투자 검토의 건</li> <li>- 양도제한조건부주식 부여의 건</li> </ul>	가결	참석

### 라. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미 실시	이사회 안건 사전 자료 제공 및 설명으로 대체
------	---------------------------

**마. 감사 지원조직 현황**

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원팀	8	팀장 등	직무수행을 위한 자료 제공

**바. 준법지원인 지원조직 현황**

- 해당사항 없음

**3. 주주총회 등에 관한 사항**

**가. 투표제도 현황**

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	부	부	제16기(2021년도) 정기주총

주1) 당사는 제17기 정기주주총회에 의결권대리행사권유제도를 채택하였으나, 전자투표는 시행하지 않았습니다.

**나. 소수주주권 행사**

- 해당사항 없음

**다. 경영권 경쟁**

- 해당사항 없음

**라. 의결권 현황**

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	17,780,753	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	1,281,999	자기주식
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	16,498,754	-
	우선주	-	-

#### 마. 주식사무

<b>정관상 신주인수권의 내 용</b>	<p>① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. &lt;삭 제&gt;</p> <p>2. 발행주식총수의 100분의 50범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에 신주를 우선하여 배정하는 경우</p> <p>4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조의 규정에 의하여 증권의탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>7. 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내,외의 금융기관(기관 투자가 및 각종 연기금 포함) 및 국내,외 투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>8. 기술의 도입을 필요로 그 제휴회사 및 국내,외 투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.</p>		
<b>결산일</b>	12월 31일	정기주주총회	매결산기마다 소집
<b>주주명부 폐쇄기준일</b>	회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.		
<b>주권의 종류</b>	2019년 9월 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 사채 등 증권의 전자등록 의무화로 인해 실물증권이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않음		
<b>명의개서 대리인</b>	국민은행 증권대행부		
<b>주주의 특전</b>	없음	공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.abov.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

#### 바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의 내용
------	----	-------

<p>제17기 정기주주총회 (2023.03.28)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안: 제17기 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건</li> <li>- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건</li> <li>- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건</li> <li>- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건</li> <li>- 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건</li> </ul>	<p>가결 가결 가결 가결 가결</p>
<p>제16기 정기주주총회 (2022.03.24)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안: 제16기 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안: 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>제2-1호: 사내이사 김영진 선임의 건</li> <li>제2-2호: 사내이사 한대근 선임의 건</li> <li>제2-3호: 사외이사 박성우 선임의 건</li> </ul> </li> <li>- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>제3-1호: 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건</li> <li>제3-2호: 주식매수선택권 부여의 건</li> </ul> </li> <li>- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건</li> <li>- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건</li> <li>- 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건</li> </ul>	<p>가결  가결 가결 가결  가결 부결 가결 가결 부결</p>
<p>제15기 정기주주총회 (2021.03.25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안: 제15기 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건</li> <li>- 제2호 의안: 사내이사 중임의 건(최원 이사)</li> <li>- 제3호 의안: 감사 선임의 건(채재호 감사)</li> <li>- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건</li> <li>- 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건</li> <li>- 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건</li> <li>- 제7호 의안: 정관 변경의 건</li> </ul>	<p>가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결</p>

## VII. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
최원	본인	보통주	3,315,643	18.65	3,315,643	18.65	-
최석	친인척	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-
(주)그린칩스홀딩스	계열회사	보통주	444,648	2.50	444,648	2.50	-
계		보통주	3,770,291	21.21	3,770,291	21.21	-
		-	-	-	-	-	-

주1) 최대주주 및 특수관계인은 당사 등기임원, 최대주주의 친인척 및 계열사 기준으로 작성하였습니다.

주2) 최대주주에 대한 주요경력은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

### 2. 최대주주의 변동내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고
-	최원	3,770,291	21.21	최대주주 변동내역 없음	-

(주1) 상기 주식수와 지분율은 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 포함한 수치입니다.

### 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	최원	3,315,643	18.65	-
	-	-	-	-
우리사주조합		-	-	-

### 4. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구분	주주			소유주식			비고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	28,844	28,848	99.99	11,828,537	16,498,754	71.69	-

주1) 소액주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.

주2) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.

주3) 총발행주식수는 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수로 작성하였습니다.

## 5. 주가 및 주식거래실적

(단위: 원, 주)

종 류		2023년 04월	2023년 05월	2023년 06월	2023년 07월	2023년 08월	2023년 09월	
보통주	주가	최고주가	11,540	10,520	11,020	11,200	10,060	9,630
		최저주가	9,990	9,390	10,150	9,570	8,900	8,210
		평균주가	10,833	<b>9,956</b>	10,573	10,528	9,344	9,062
	거래량	최고 일거래량	816,463	1,094,711	639,966	982,410	262,554	413,203
		최저 일거래량	96,014	48,258	96,881	85,120	52,989	33,300
		월간 거래량	6,608,397	4,715,455	4,492,659	5,966,388	2,528,846	1,733,943

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

#### 임원 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
최원	남	1963.02	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 한국항공대 항공통신정보공학과 - 전 LG반도체 MCU영업팀 팀장 - 전 (주)그린칩스 대표이사 - 현 어보브반도체주 대표이사	3,315,643	-	본인	17.7년	2024.03.28
김경호	남	1961.02	대표이사	사내이사	상근	경영전반	- KAIST 전기 및 전자공학과 공학박사 - 전 삼성전자 시스템 LSI사업부 - 전 연세대 교수 - 현 어보브반도체(주) 대표이사	-	-	-	1.7년	2026.03.28
한대근	남	1960.05	사내이사	사내이사	상근	고문	- 경북대 전자공학과 석사 - LG반도체 근무 - 전 실리콘웍스 대표이사 - 현 어보브반도체(주) 고문	-	-	-	5.5년	2025.03.29
박성우	남	1962.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 미국 캘리포니아주립대학교 전기 및 전자정보공학박사 - 현 한남대학교 정보통신공학과 교수	-	-	-	1.5년	2025.03.29
채재호	남	1955.08	감사	감사	상근	감사	- 연세대 전자공학 학사 - 전 LG반도체(주) 사업담당 - 전 하이닉스 반도체 상무 - 전 동부하이텍 전략담당 부사장 - 전 어보브반도체(주) 개발본부 부사장 - 현 어보브반도체(주) 감사	-	-	-	2.5년	2024.03.25
박호진	남	1962.09	부사장	미등기	상근	개발본부장	- 원양대 전기공학과 학사 - 전 삼성전자 SYSTEM LSI 사업부 - 파워제품개발 팀장(전무) - 현 어보브반도체(주) 개발본부장	-	-	-	2.7년	-
김정훈	남	1964.06	부사장	미등기	상근	생산본부장	- 성균관대 전기공학 학사 - 전 매그나칩반도체 생산관리 부장 - 현 어보브반도체(주) 생산본부장	49,890	-	-	14.2년	-
윤호권	남	1968.01	부사장	미등기	상근	영업마케팅 본부장	- 미국 오하이오주립대학교 전자공학 박사 - 전 미국 인텔(사) HSSIO Design Manager - 전 삼성전기 상무 상품기획팀장 - 현 어보브반도체(주) 영업마케팅 본부장	-	-	-	2.6년	-
이수민	남	1967.02	부사장	미등기	상근	경영본부장	- 서울대 무기재료공학 / 코벌대 MBA - 전 삼성전자 경영지원실 자금팀 - 전 삼성전자 북미총괄 경영지원팀 - 현 어보브반도체(주) CFO	-	-	-	2.3년	-

김사현	남	1970.04	상무이사	미등기	상근	전략제품개발센터장	- 한양대 전기공학과 학사 - 전 LG반도체 / 전 하이닉스 반도체 / 전 매그나칩 반도체 / 전 디스플레이칩사 근무 - 현 어보브반도체(주) 전략제품개발센터 총괄	-	-	-	15.1년	-
김현일	남	1969.11	상무이사	미등기	상근	설계그룹	- 광운대 전자공학과 학사 - 전 LG반도체 / 전 하이닉스 반도체 / 전 매그나칩 반도체 근무 - 현 어보브반도체(주) 설계그룹 개발 총괄	-	-	-	17.7년	-
서영진	남	1972.09	상무이사	미등기	상근	응용그룹	- 대전대 전자공학과 석사 - 전 넥스트칩 응용팀장 - 현 어보브반도체(주) 응용그룹 개발 총괄	-	-	-	10.8년	-
김용천	남	1965.09	상무이사	미등기	상근	혁신제품개발그룹	- 연세대 전기공학과 학사 - 전 삼성전자 반도체 LSI MCU개발그룹장, ODD 개발그룹장 - 전 삼성SDI 기술고문 - 현 어보브반도체(주) 혁신제품그룹 개발 총괄	-	-	-	3.4년	-
이규택	남	1959.12	상무이사	미등기	상근	PE그룹	- 영남대학교 전자공학과 학사 - 전 삼성전자 System LSI 사업부 제품기술팀 그룹장 - 현 어보브반도체(주) PE 그룹 총괄	-	-	-	2.7년	-
최재경	남	1963.01	ABOV HK 고문	미등기	상근	ABOV HK 고문	- 인하대 산업공학과 학사 - 전 그린칩스 상해법인장 - 전 어보브반도체(주) 홍콩법인장 - 전 어보브반도체(주) 홍콩법인 영업전무 - 현 어보브반도체(주) 홍콩법인 고문	42,970	-	-	9.7년	-
채용재	남	1972.02	상무이사	미등기	상근	ABOV HK	- 조선대 기계공학 학사 - 전 시그네틱스 코리아 - 전 (주)티엘아이 베이징지사장 - 현 어보브반도체(주) 중국법인 법인장	-	-	-	15.2년	-
김진균	남	1971.05	상무이사	미등기	상근	ABOV HK	- 서울대 전기공학 석사 - 전 LG반도체 / 현대전자 / 하이닉스 / 매그나칩반도체 근무 - 현 어보브반도체(주) 홍콩법인 지사장	-	-	-	17.7년	-
최재하	남	1970.12	상무이사	미등기	상근	마케팅 그룹장	- 연세대 물리학과 학사 - 전 LG반도체 상품기획팀 - 전 하이닉스 DM 마케팅팀 - 전 매그나칩반도체 AP 마케팅팀 - 현 어보브반도체(주) 마케팅 그룹장	24,000	-	-	17.7년	-
최경환	남	1973.09	상무이사	미등기	상근	영업 그룹장	- 단국대 전기공학 학사 - 전 매그나칩반도체 영업본부 근무 - 현 어보브반도체(주) 영업 그룹장	-	-	-	17.7년	-
박상배	남	1970.03	상무이사	미등기	상근	SCM 그룹장	- 연세대 공학대학원 재료공학 석사 - 전 Motorola Korea / R&QA/EHS - 전 ASE Korea / 품질부서 이사 - 현 어보브반도체(주) SCM 그룹장	1,000	-	-	2.6년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황



- 해당사항 없음

**다. 등기임원의 타회사 임원 겸직현황**

(기준일 : 2023년 09월 30일)

겸직자		겸직회사	
성명	직위	회사명	직위
최원	대표이사	(주)그린칩스홀딩스	대표이사
		(주)그린칩스	사내이사
		(주)코텍세미컴	사내이사
		(주)오토실리콘	사내이사
		(주)라운크리에이트	사내이사
		(주)원팩	사내이사

**라. 미등기임원의 변동**

- 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 없습니다.

**마. 직원 현황**

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 천원)

직원								소속 외 근로자			비고		
사업부문	성별	직원 수					평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	남		여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
MCU	남	180	-	-	-	180	7.0	12,174,295	67,635	-	-	-	-
MCU	여	46	-	1	-	47	5.5	1,881,847	40,039	-	-	-	-
합계		226	-	1	-	227	6.7	14,056,143	61,921				-

**바. 미등기임원 보수 현황**

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 천원)

구분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	14	1,752,954	125,211	-

**2. 임원의 보수 등**

<이사·감사 전체의 보수현황>

**1. 주주총회 승인금액**

(단위 : 천원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	4명	2,000,000	-
감사	1명	300,000	-

## 2. 보수지급금액

### 2-1. 이사·감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
4	496,193	124,048	-

### 2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	458,690	152,897	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	37,503	37,503	-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황>

### 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

### 2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권	-	-

		행사이익		
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

### 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

### 2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권	-	-
		행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

### 1. 이사·감사등 에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분	부여받은 인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	127	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
업무집행지시자 등	5	596	-
계	6	723	-

<표2>

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사 가격	의무 보유 여부	의무 보유 기간
						행사	취소	행사	취소					
최재하	미등기임원	2017년 01월 03일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	2020.01.03~2025.01.02	8,423	X	-
손재철	미등기임원	2020년 02월 24일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2023.02.25~2026.02.24	9,088	X	-
손재철	미등기임원	2021년 03월 25일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2024.03.24~2027.03.23	13,812	X	-
최재경	계열회사 임원	2021년 03월 25일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2024.03.24~2027.03.23	13,812	X	-
박호진	미등기임원	2021년 03월 25일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	2024.03.24~2027.03.23	13,812	X	-
윤호권	미등기임원	2021년 07월 16일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	2024.07.15~2027.07.14	15,058	X	-
김경호	미등기임원	2022년 04월 04일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2025.04.03~2028.04.02	12,568	X	-
윤호권	미등기임원	2023년 04월 27일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	2026.04.27~2029.04.26	10,879	X	-
박호진	미등기임원	2023년 04월 27일	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	2026.04.27~2029.04.26	10,879	X	-

주1) 공시서류작성기준일(2023년 09월 30일) 현재 증가 : 8,360원

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

### 1. 계열회사 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
대표회사: 어보브반도체(주)	2	13	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

### 2. 계열회사 계통도

당사가 속한 기업집단은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 대상 기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사간의 상호출자 계통도는 아래와 같습니다.

구 분		출자회사			
		어보브반도체(주)	(주)그린칩스홀딩스	(주)노매드투어	원팩
피출자 회사	어보브반도체(주)	7.2%	2.50%	-	-
	ABOV HK	100.0%	-	-	-
	ABOV VINA	100.0%			
	화인칩스(주)	29.5%	-	-	-
	(주)오토실리콘	40.9%	-	-	-
	(주)다빈칩스	43.5%	-	-	-
	(주)원팩	38.3%	-	-	-
	(주)코텍세미컴	-	100.00%	-	-
	(주)라운크리에이트	-	100.00%	-	-
	(주)노매드투어	-	65.79%	-	-
	노매드 재팬	-	-	100.00%	-
	티더블유메디칼	-	-	-	22.9%

### 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직자		겸직회사	
성 명	직 위	회사명	직 위
최 원	대표이사	(주)그린칩스홀딩스	대표이사
		(주)그린칩스	사내이사
		(주)코텍세미컴	사내이사
		(주)오토실리콘	사내이사
		(주)라운크리에이트	사내이사

		(주)원팩	사내이사
--	--	-------	------

#### 4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	1	2	3	44,594	158	-	44,752
일반투자	-	4	4	6,026	1,858	-	7,884
단순투자	-	5	5	4,654	40	-	4,694
계	1	11	12	55,274	2,056	-	57,330

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

## X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음

3. 대주주(등)와의 영업거래

<당분기>

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출	매입
	제품/상품매출	기타
ABOV H.K.	22,917,617	-
ABOV VINA	-	509,814
화인칩스(주)	57,183	3,627,827
(주)그린칩스	11,316,905	-
노매드투어	-	30,000
주식회사 스카이칩스	-	164,835
(주)원팩	-	1,707,530
합 계	34,291,705	6,040,006

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

### 2. 우발부채 등에 관한 사항

#### 가. 중요한 소송사건

- 해당사항 없음

#### 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

- 해당사항 없음

#### 다. 채무보증 현황

당분기말 현재 당사가 특수관계자 및 타인을 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 백만원)

특수관계자구분	제공받은회사	여신금융기관	여신금액	보증금액	비고
종속기업	(주)원팩	한국수출입은행	2,500	3,000	금융기관 차입보증

#### 라. 채무인수약정 현황

- 해당사항 없음

#### 마. 그 밖의 우발채무 등

- 본 보고서 III. 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

### 3. 제재 등과 관련된 사항

(단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처분 또는 조치내용	금전적제재금액	사유 및 근거법령
2022.01.18	광주세관	당사	-과세가격 가산요소 누락 -부당감면 -상계신고누락	432	-관세법 제30조제1항제3호 및 동법 시행령 제18조제4호, 관세법 시행규칙 제4조제3항제4호 -관세법 제101조제1항제1호 및 관세법 시행령 제119조, 부가가치세법 시행령 제54조 -외국환거래법 제16조제1호 및 동법 제32조제1항제3호, 외국환거래법 시행령 별표4



주1) 상기 일자는 광주세관으로부터 전달받은 최종결과통지서 일자입니다.

주2) 당사는 광주세관으로부터 2021년 중 2016년 10월부터 2021년 10월까지 기간동안의 과세가격, 외환, 통관요건 등 전부심사(FTA원산지 제외)를 받았으며, 부가세 1,437백만원과 가산세 432백만원, 과태료 2백만원 등 총 1,871백만원의 추정액 및 과태료를 고지받았습니다.

해당 부가세 및 가산세 추정액은 2021년 12월 전액 납부하였고, 과태료는 2022년 1월에 전액 납부하였습니다. 당사는 해당 금액을 부가세예수금 및 세금과공과로 계상하였습니다.

공시서류제출일 현재 부가세 1,437 백만원에 대해서는 2022년 5월 4일자로 수정수입세금계산서가 발행 되어 종결 되었고, 가산세 432백만원 추정액에 대해서만 후속업무가 진행중에 있습니다.

주3) 당사는 재발방지를 위하여 내부업무절차를 재정립하였습니다.

#### 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음.

## XII. 상세표

### 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
ABOV Semiconductor (HK) Co Limited	2006.01	Room 25B, 25/F, 235 Wing Lok Street Trade Centre, Sheung Wan, Hong Kong	MCU 중국 판매	7,370,997	의결권의 과반수 소유 (한국채택국제회계기준 1110호)	미해당
ABOV Semiconductor VINA Co., Ltd	2022.01	No. K28-group k, khu nha ban yen hoa, yen hoa ward, cau giay district, hanoi, Vietnam	반도체 설계 용역	120	의결권의 과반수 소유 (한국채택국제회계기준 1110호)	미해당
(주)원팩	2002.04	경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50	반도체 제조, 생산	178,542,709	실질지배력 보유 (한국채택국제회계기준 1110호)	해당 (자산총계 750억원이 상)

### 2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	2	어보브반도체(주)	150111-0093926
		(주)원팩	134411-0020543
비상장	13	ABOV Semiconductor (HK) Co Limited	1022254
		ABOV Semiconductor VINA Co., Ltd	109876363
		화인칩스(주)	131111-0057917
		(주)오토실리콘	110111-6823458
		(주)다빈칩스	110111-2600131
		(주)그린칩스홀딩스	110111-1210593
		(주)그린칩스	131111-0616606
		(주)코텍플러스	110111-3249045
		(주)코텍세미컴	110111-2008955
		(주)라온크리에이트	120111-0795734
		(주)노매드투어	110111-6406767
노매드재팬	3300-01-019650		
티더블유메디칼	110111-5957430		

### 3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
								수량	금액						
ABOV HK	비상장	2006.11.27	경영참여	1	10,000	100.00	1,119	-	158	-	10,000	100.00	1,277	7,371	-2,527
ABOV VINA	비상장	2022.03.04	경영참여	120	0	100.00	120	-	-	-	-	100.00	120	120	-
㈜원팩	상장	2021.12.22	경영참여	51,000	22,827,960	38.31	43,355	-	-	-	22,827,960	38.31	43,355	178,543	-1,571
화인칩스(주)	비상장	2009.09.01	일반투자	1,500	18,000	29.46	2,250	-	-	-	18,000	29.46	2,250	15,837	3,734
(주)다빈칩스	비상장	2014.10.20	일반투자	2,000	61,539	43.48	0	-	-	-	61,539	43.48	-	883	-273
(주)오토살리콘	비상장	2018.07.25	일반투자	5,001	759,375	40.50	2,576	170,085	1,858	-	929,460	40.85	4,434	2,347	-4,157
관악아날로그(주)	비상장	2019.03.25	일반투자	1,200	5,555	7.14	1,200	49,995	-	-	55,550	7.14	1,200	1,734	-765
(주)스카이칩스	비상장	2020.09.23	단순투자	1,600	45,185	13.25	2,491	1,084,440	-	-	1,129,625	11.44	2,491	16,819	-8,154
Eta Compute, Inc	비상장	2017.12.31	단순투자	321	325,212	0.98	0	-	-	-	325,212	0.98	-	1,583	-4,792
2017메가RS투자조합	비상장	2017.12.31	단순투자	200	835	5.00	1,166	-	-	-	835	5.00	1,166	10,288	-2,877
㈜씨니웨이브텍	비상장	2021.06.25	단순투자	997	38,780	9.07	997	-	-	-	38,780	9.07	997	1,846	-371
혁신 IP 기술사업화 투자조합	비상장	2023.06.07	단순투자	0	0	0.00	0	40	40	-	40	0.33	40	-	-
합 계					-	-	55,274	-	2,056	-	-	-	57,330	-	-

### 【 전문가의 확인 】

#### 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

#### 2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음